T2K 長基線ニュートリノ振動実験 ミューオンモニターにおける CVDダイヤモンド検出器の研究

大阪市立大学大学院 理学研究科 数物系専攻 高エネルギー物理研究室 前田 圭介

2008年2月

概要

今回、T2K 長基線ニュートリノ振動実験におけるミューオンモニターで使用する、CVD ダイヤモンド検出器について研究した。

T2K 実験は、現在茨城県東海村に建設中の J-PARC でほぼ純粋なミューオンニュート リノビームを生成し、それを 295 km 離れたスーパーカミオカンデで観測する次期長基線 ニュートリノ振動実験である。2009 年 4 月に物理ラン開始予定であり、世界最大強度の ニュートリノビームを達成する。このニュートリノビームを用いて、電子ニュートリノ出 現事象の探索、ミューオンニュートリノ消失の振動パラメータの精密測定を行う。しかし、 これらのニュートリノ振動の詳細な研究を行うためには、ニュートリノビーム方向を精度 よくモニターする必要がある。その役割を担うのが、ミューオンモニターである。

ミューオンモニターは、親のπ中間子からニュートリノと共に出てくるミューオンの位 置プロファイルを測定することでニュートリノの方向と強度をモニターする装置である。 ニュートリノビームの方向をニュートリノ振動解析の物理的要請を満たすよう、1 mrad 以 上の精度でパルスごとにモニターすることを目指す。

まず、ミューオンや他の粒子の強度、位置プロファイルの形、ミューオンモニターにおける 放射線強度を調べ、検出器に必要な性能を求めた。見積もった放射線強度は約10⁸ particles /cm²/pulse で、検出器にはこの大強度の放射線環境下での長期安定性が求められる。そこ で、その大強度に耐えうる半導体検出器としてダイヤモンド検出器を採用した。物理ラン 実験でダイヤモンド検出器を使用するのは、このT2K実験が世界初となる。ダイヤモンド は CVD ダイヤモンドを用いる。

次に、CVDダイヤモンド検出器の性能を評価するため、電子ビーム(100MeV 電子線形 加速器)を照射するビームテストを行った。その結果、線形性についてはミューオンモニ ター検出器の要請を満たすことが分かり、それをもとに実機でのチャンネル数を決定した。 また、各サンプルの応答に個体差が見られその電極を調べたところ、一部に剥離が確認さ れた。そこで個体差との関連性を調べると、電極面積が応答の個体差に関係していると思 われる結果が出た。よって、ダイヤモンド自体の個体差ではないと考えられる。

以上のビームテストの結果から、CVDダイヤモンド検出器がミューオンモニターにおけ る必要な性能を満たすことが確かめられた。

目 次

第1章	序論	1
1.1	ニュートリノの質量固有状態と混合状態	1
1.2	ニュートリノ振動................................	2
第2章	T2K 実験	5
2.1	実験の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	5
	2.1.1 J-PARC ニュートリノビームライン	6
	2.1.2 スーパーカミオカンデ	7
	2.1.3 Off-axis ビーム	10
2.2	実験の目的	11
	2.2.1 電子ニュートリノ出現事象の探索	11
	2.2.2 ミューオンニュートリノ消失の振動パラメータの精密測定	13
2.3	実験計画	17
2.4	ミューオンモニターに対する物理的要請	18
第3章	T2K ミューオンモニターへの物理的要請と設計	19
第3章 3.1	T2K ミューオンモニターへの物理的要請と設計 T2K ビームラインシミュレーション	19 19
第3章 3.1	T2K ミューオンモニターへの物理的要請と設計 T2K ビームラインシミュレーション	19 19
第3章 3.1	T2K ミューオンモニターへの物理的要請と設計 T2K ビームラインシミュレーション	19 19 22
第 3 章 3.1	T2K ミューオンモニターへの物理的要請と設計 T2K ビームラインシミュレーション 3.1.1 ミューオンモニターにおける粒子のフラックス、位置プロファイル、 エネルギー分布 3.1.2 陽子ビーム照射位置に対する感度	 19 19 22 25
第 3 章 3.1	T2K ミューオンモニターへの物理的要請と設計 T2K ビームラインシミュレーション 3.1.1 ミューオンモニターにおける粒子のフラックス、位置プロファイル、 エネルギー分布 3.1.2 陽子ビーム照射位置に対する感度 3.1.3	 19 19 22 25 27
第3章 3.1 3.2	T2K ミューオンモニターへの物理的要請と設計 T2K ビームラインシミュレーション 3.1.1 ミューオンモニターにおける粒子のフラックス、位置プロファイル、 エネルギー分布 3.1.2 陽子ビーム照射位置に対する感度 3.1.3 ミューオンモニターに用いる検出器	 19 19 22 25 27 27
第3章 3.1 3.2	T2K ミューオンモニターへの物理的要請と設計 T2K ビームラインシミュレーション 3.1.1 ミューオンモニターにおける粒子のフラックス、位置プロファイル、 エネルギー分布 3.1.2 陽子ビーム照射位置に対する感度 3.1.3 ミューオンモニターに用いる検出器 3.2.1 シリコン PIN フォトダイオード	 19 19 22 25 27 27 27 27
第3章 3.1 3.2	T2K ミューオンモニターへの物理的要請と設計 T2K ビームラインシミュレーション 3.1.1 ミューオンモニターにおける粒子のフラックス、位置プロファイル、 エネルギー分布 3.1.2 陽子ビーム照射位置に対する感度 3.1.3 ミューオンモニターのサイズ ミューオンモニターに用いる検出器 3.2.1 シリコン PIN フォトダイオード 3.2.2 CVDダイヤモンド検出器	 19 19 22 25 27 27 27 27 27
第3章 3.1 3.2	T2K ミューオンモニターへの物理的要請と設計 T2K ビームラインシミュレーション 3.1.1 ミューオンモニターにおける粒子のフラックス、位置プロファイル、 エネルギー分布 3.1.2 陽子ビーム照射位置に対する感度 3.1.3 ミューオンモニターのサイズ ミューオンモニターに用いる検出器 3.2.1 シリコン PIN フォトダイオード 3.2.2 CVD ダイヤモンド検出器 3.2.3 平行平板型イオンチェンバー	 19 19 22 25 27 27 27 27 27 28
第3章 3.1 3.2 3.3	T2K ミューオンモニターへの物理的要請と設計 T2K ビームラインシミュレーション 3.1.1 ミューオンモニターにおける粒子のフラックス、位置プロファイル、 エネルギー分布 3.1.2 陽子ビーム照射位置に対する感度 3.1.3 ミューオンモニターのサイズ ミューオンモニターに用いる検出器 3.2.1 シリコン PIN フォトダイオード 3.2.2 CVDダイヤモンド検出器 3.2.3 平行平板型イオンチェンバー 3.2.4	 19 19 22 25 27 27 27 27 28 28
第3章 3.1 3.2 3.3	 T2K ミューオンモニターへの物理的要請と設計 T2K ビームラインシミュレーション 3.1.1 ミューオンモニターにおける粒子のフラックス、位置プロファイル、 エネルギー分布 3.1.2 陽子ビーム照射位置に対する感度 3.1.3 ミューオンモニターのサイズ ミューオンモニターに用いる検出器 3.2.1 シリコン PIN フォトダイオード 3.2.2 CVD ダイヤモンド検出器 3.2.3 平行平板型イオンチェンバー シミュレーションによるミューオンモニターのデザイン 3.3.1 放射線損傷 	 19 19 22 25 27 27 27 27 28 28 28

第4章	CVD ダイヤモンド 検出器	35
4.1	CVD ダイヤモンド 検出器の仕様	35
4.2	CVDダイヤモンドの性質	36
	4.2.1 ダイヤモンドの物理的性質	36
	4.2.2 人工ダイヤモンドの生成方法	36
4.3	CVD ダイヤモンド 検出器の動作原理	38
第5章	ビームテストによる CVD ダイヤモンド 検出器の性能評価	43
5.1	ビームテスト 1、2	43
	5.1.1 ビームテストのビームパラメータ	44
	5.1.2 ビームテスト 1 (2005 年 10 月) のセットアップ	45
	5.1.3 ビームテスト 2 (2006 年 7 月) のセットアップ	45
	5.1.4 CVD ダイヤモンド 検出器の性能評価	48
	5.1.5 測定結果のまとめ	65
5.2	ビームテスト (2007年6月)	67
	5.2.1 セットアップとビームパラメータ	67
	5.2.2 シグナルの波形	69
	5.2.3 応答の個体差	69
	5.2.4 電極面積との関係性	73
	5.2.5 結果	76
第6章	ミューオンモニターのデザイン	80
6.1	検出器の配置とチャンネル数、プロファイル中心の決定精度	80
第7章	結論と今後	81
付録A	電磁ホーン	82
謝辞		85
参考文南	ξ	86

第1章 序論

ニュートリノは、重力相互作用を除き、弱い相互作用のみする中性レプトンである。1930 年に Pauli によってその存在が予言され、1935 年に Fermi によって理論づけられたが、弱 い相互作用しかしないため、ニュートリノを直接検出するのは非常に困難であった。1956 年に Reines と Cowan によってその存在が初めて確認された。

現在の素粒子標準模型において、ニュートリノには3世代あり、その質量は0として扱われている。ところが1998年、Super-KAMIOKANDEグループによる大気ニュートリノの観測から、ニュートリノは有限の質量をもち、なおかつ世代間で振動しているということが示唆された。そして現在、そのニュートリノ振動は先の長基線ニュートリノ振動実験である K2K 実験によって確立されたものになっている。しかし、3世代間のニュートリノ振動はまだ発見されておらず、ニュートリノの質量についても上限が与えられているにすぎない。ニュートリノ振動のパラメータを測定することで、素粒子論や宇宙論に大きな手がかりを与えることができる。

本章では、ニュートリノの質量固有状態の混合状態とニュートリノ振動について述べる。

1.1 ニュートリノの質量固有状態と混合状態

ニュートリノの質量のラグランジアンは、ニュートリノがディラック粒子のとき、

$$\mathcal{L}^{m} = -\sum_{l,l'} \overline{\nu_{l'\mathrm{R}}} M_{l'l} \nu_{l\mathrm{L}} + \mathrm{h.c.}$$
(1.1)

と書ける。ここで、lはフレーバー(e, μ, τ)を表し、L,Rはヘリシティーを表している。 また、Mは複素 3×3 行列である。この Mを対角化するために、二重ユニタリ変換を行う

$$M^{\rm D} = V m U^{\dagger}. \tag{1.2}$$

ここで、 $VV^{\dagger} = 1, UU^{\dagger} = 1, m_{ij} = m_i \delta_{ij}, m_i > 0$ であり、式 (1.1) は、

$$\mathcal{L}^{m} = -\sum_{l,l',i} \overline{\nu_{l'\mathbf{R}}} V_{l'i} m_{i} (U^{\dagger})_{il} \nu_{l\mathbf{L}} + \text{h.c.} = -\sum_{i=1}^{3} m_{i} \overline{\nu_{i}} \nu_{i}$$
(1.3)

となる。ここで、 ν_i は質量の固有状態で、

$$\nu_i = \nu_{i\mathrm{L}} + \nu_{i\mathrm{R}} \quad (i = 1, 2, 3), \tag{1.4}$$

1

第1章 序論

$$\nu_{i\mathrm{L}} = \sum_{l} (U^{\dagger})_{il} \nu_{l\mathrm{L}},\tag{1.5}$$

$$\nu_{i\mathrm{R}} = \sum_{l} (V^{\dagger})_{il} \nu_{l\mathrm{R}} \tag{1.6}$$

である。ニュートリノは弱い相互作用しかしないので、左巻きのもの(L)だけが観測で きる。

したがって、ニュートリノの混合状態は、

$$\nu_{lL} = \sum_{i} U_{li} \nu_{iL} \tag{1.7}$$

と表される。

1.2 ニュートリノ振動

ニュートリノ振動とは、ある種類のニュートリノが時間発展とともに別の種類のニュー トリノに変化する現象である。この現象は、ニュートリノが有限な質量を持ち、かつフレー バー固有状態と質量固有状態が異なり、さらに3つの質量固有状態が1つに縮退していな い場合に起こる。ニュートリノのフレーバー固有状態を |ν_l〉、質量固有状態を |ν_i〉とする と、フレーバー固有状態は、

$$|\nu_l\rangle = \sum_i U_{li} |\nu_i\rangle \tag{1.8}$$

と表される。

行列 U_{li} は、Maki-Nakagawa-Sakata-Pontecorvo (MNSP) 混合行列と呼ばれ、

$$U_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & c_{23} & s_{23} \\ 0 & -s_{23} & c_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{13} & 0 & e^{-i\delta}s_{13} \\ 0 & 1 & 0 \\ -e^{i\delta}s_{13} & 0 & c_{13} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{12} & s_{12} & 0 \\ -s_{12} & c_{12} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
(1.9)

で表される。ここで、 $c_{ij} \equiv \cos \theta_{ij}$ 、 $s_{ij} \equiv \sin \theta_{ij}$ であり、 θ_{ij} は $\nu_i \ge \nu_j$ の混合角、 δ は CP 非保存の位相となっている。

次に時間発展について考える。質量の各成分は同じ運動量を持っているとすると、

$$E_i = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m_i^2} \simeq |\mathbf{p}| + \frac{m_i^2}{2|\mathbf{p}|}$$
 (1.10)

となるので、フレーバー固有状態の時間発展は、

$$|\nu_l(t)\rangle = \sum_i e^{-iE_i t} U_{li} |\nu_i\rangle \tag{1.11}$$

と表される。このとき、このニュートリノが $\nu_{l'}$ として観測される確率は、

$$P(\nu_l \to \nu_{l'}) = |\langle \nu_{l'} | \nu_l(t) \rangle|^2$$
(1.12)

$$= |\sum_{i} e^{-iE_{i}t} U_{li} U_{l'i}^{*}|^{2}$$
(1.13)

となる。ここでニュートリノが極めて相対論的であることを考慮すると、 $m_i \ll E_i$ より、 $t \approx L$ および $|\mathbf{p}| \approx E$ となる。簡単のため 2 フレーバーの場合を考えると、これらより、 L = 0においてフレーバー *l* であったニュートリノが距離 *L*を飛行した後にフレーバー *l*' になっている確率は、式 (1.13) から、

$$P(\nu_l \to \nu_{l'}) = \sin^2 2\theta \sin^2 \left(\frac{\Delta m^2}{4E}L\right)$$
(1.14)

$$= \sin^2 2\theta \sin^2 \left(\frac{1.27\Delta m^2 [eV^2] L[km]}{E[GeV]} \right)$$
(1.15)

となる。ここでは、ある決まったエネルギーのニュートリノを考えたため、 E_i の代わりに Eを用いた。また、 Δm^2 は質量 2 乗差である。

この式 (1.15) より、ニュートリノ振動の効果が最もよく現れるニュートリノのエネル ギーは、

$$\frac{1.27\Delta m^2 [\text{eV}^2] L[\text{km}]}{E[\text{GeV}]} = \frac{\pi}{2}$$
(1.16)

より求められる。加速器を用いたニュートリノ振動実験においては、距離 L は定まってい るので、ニュートリノのエネルギーをこの式に合うようにコントロールすることで、ニュー トリノ振動に対する実験感度をあげることができる。



図 1.1: (左)K2K 実験グループのミューオンニュートリノ欠損の解析によって得られた、 ニュートリノ質量の二乗差とニュートリノの混合度と信頼度。 (右)スーパーカミオカ ンデで測定されたミューオンニュートリノのエネルギー分布。白丸は実際の測定値。青線 と赤線はそれぞれニュートリノ振動がない場合とある場合の予測値。

第2章 T2K実験

この章では、T2K 実験の概要と目的および特色について述べ、また T2K におけるミュー オンモニターの役割についても説明する。

2.1 実験の概要

T2K(Tokai to Kamioka)実験は、茨城県東海村に建設中の大強度陽子加速器計画(J-PARC: Japan Proton Accelerator Research Complex)でほぼ純粋なミューオンニュートリ ノビームを生成し、それを 295 km 離れた岐阜県飛騨市にある大型水チェレンコフ観測装置 スーパーカミオカンデ(Super-KAMIOKANDE: Super-KAMIOKA Neutrino Detection Experiment(通称 Super-K))で観測する、次期長基線ニュートリノ振動実験である。

T2K 実験の主な目的は以下の3つである。

- 電子ニュートリノ出現事象 ($\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{e}$)の探索
- ミューオンニュートリノ消失の振動パラメータの精密測定
- 相互作用しないステライルニュートリノ(ν_s)の探索

これらのニュートリノ振動の効果は、ニュートリノ生成標的から 280 m の位置に設置する 前置検出器(ND280)で、生成直後のニュートリノのフラックス、エネルギースペクトル を精密に測定し、それを Super-K での観測結果と比較することで測定する。

次に T2K 実験の特色を挙げる。

● 世界最大のニュートリノビーム強度

J-PARC の 50 GeV 陽子シンクロトロンからの陽子ビーム(ビーム強度: 750 kW) を用いてニュートリノビームを生成する。5年のランで 5×10^{21} POT (Proton On Target:標的に照射した陽子数)を目指す。表 2.1 に T2K 実験における陽子ビーム パラメータ、図 2.1 に陽子ビームの時間構造を示す。

世界最大のニュートリノ観測装置 Super-K
 後置検出器として Super-K を用いる。Super-K は約 50 kt (有効体積: 22.5 kt)の純

水を湛える大型水チェレンコフ検出器で、実働する世界最大のニュートリノ観測装置 である。

Off-axis ビーム

ビーム軸を Super-K の方向から 2 ~ 2.5° ずらすことで、エネルギースペクトル幅の 狭いニュートリノビームが得られる。これにより、スペクトルのピークをニュートリ ノ振動の効果が最大となるエネルギー領域(0.5 ~ 0.7 GeV)に合わせ、かつバック グラウンド事象を引き起こすエネルギーのニュートリノの数を抑えることができる。

ビームエネルギー	$50 { m GeV}$
ビーム強度	$750 \mathrm{kW}$
スピル中の陽子数	$3.3 \times 10^{14} \text{ p/spill}$
スピルの振動数	$0.285~\mathrm{Hz}$
スピル幅	5.6 μsec
バンチ数	8 /spill
バンチ幅	58 nsec
バンチ間隔	${\sim}700$ nsec

表 2.1: 陽子ビームパラメータ(デザイン値)。



図 2.1: T2K 実験における陽子ビームの時間構造。

2.1.1 J-PARCニュートリノビームライン

J-PARCは、400 MeV線形加速器(LINAC:LINear ACcelerator)、3 GeV 陽子シンクロ トロン(RCS:Rapid-Cycling Synchrotron)、50 GeV 陽子シンクロトロン(MR:Magnetic Resonance)で構成される(図 2.2)。MR の陽子ビームをグラファイト標的に照射し、生成した π 中間子を電磁ホーンで収束させ、さらに 93 m 長の崩壊トンネルで崩壊させることでニュートリノビームを生成する。

p(beam)+ graphite(target)
$$\rightarrow \pi^+ + \pi^- \cdots$$
 (2.1)

$$\pi^+ \to \mu^+ + \nu_\mu \tag{2.2}$$

崩壊トンネルの終端、グラファイトから 110 m の位置にはビームダンプが置かれ、ここ で陽子や崩壊せずに残った π 中間子などのハドロン、低エネルギーのミューオンなどが吸 収される。

π中間子の崩壊は2体崩壊なので、娘粒子のニュートリノとミューオンのプロファイルには強い相関がある。よって、ニュートリノビームの方向、つまりグラファイト標的とニュートリノプロファイル中心とを結ぶ直線の方向は、ビームダンプ直後のミューオンモニターでビームダンプを突き抜けてきたミューオンのプロファイルを測定することで間接的にモニターする。大強度のミューオンを測定するので、ミューオンモニターではバンチごとのモニターが可能である。

グラファイト標的から 280 m 下流に ND280 が設置される。ND280 は、ビーム軸上の onaxis 検出器と、崩壊トンネルの平均 π 中間子崩壊点と Super-K の線上に置かれる off-axis 検出器からなる。On-axis 検出器は、ニュートリノビームの方向をニュートリノ自身を用い てモニターするための検出器である。ニュートリノの反応断面積は非常に小さいが、T2K 実験のニュートリノビームは大強度であるので、1 日ごとのモニターが可能である。一方 off-axis 検出器は、生成直後のニュートリノのフラックスやエネルギースペクトルを精密に 測定し、ニュートリノ振動がないとしたときの Super-K におけるフラックスやエネルギー スペクトルを予測するための検出器である。また、Super-K でのニュートリノ反応を予測 するために、ニュートリノの反応断面積の詳細な研究も行う。

2.1.2 スーパーカミオカンデ

後置検出器として Super-K を用いる。Super-K は岐阜県飛騨市の池ノ山内部にある神岡 鉱山の地下 1000 m に設置された、円筒型タンク(直径:39.3 m、高さ:41.4 m)に約 50 kt(有効体積:22.5 kt)の純水を湛える大型水チェレンコフ検出器で、世界最大のニュー トリノ観測装置である(図 2.3)。

Super-K での宇宙線ミューオンの到来頻度は地上の 10⁻⁵ 倍程度で、約 2Hz である。また、タンク内を内部検出器と外部検出器に分け、外部検出器でタンクの外から来るミューオンによる事象を識別したり、岩盤からのガンマ線などが内部検出器に侵入できないよう

第2章 T2K 実験



図 2.3: Super-Kの概観。

遮蔽している。

Super-K は内部検出器に 11,146本の 20 インチ光電子増倍管(PMT)、外部検出器に 1,885本の 8 インチ PMT を用いて、水中でニュートリノによって散乱された荷電粒子の発する

チェレンコフ光のイメージを検出する。

$$\nu_{\rm e} + {\rm n} \to {\rm e} + {\rm p}, \ \nu_{\mu} + {\rm n} \to \mu + {\rm p} \tag{2.3}$$

荷電粒子が水中での光速 c/n(c:光速、n:水の屈折率)より速く走るとき、(2.4)式で表 される角 θ の方向に円錐状にチェレンコフ光を放射する。

$$\cos\theta = \frac{1}{n\beta} \tag{2.4}$$

ここで、 $\beta = v/c$ は荷電粒子の速度である。また、単位長さ当たりに放出する光子数は、

$$\frac{dN}{dx} = 2\pi z^2 \alpha \int_{\beta n > 1} \left(1 - \frac{1}{\beta^2 n^2(\lambda)} \right) \frac{d\lambda}{\lambda^2}$$
(2.5)

である。ここで、xは荷電粒子の飛跡の長さ、zは粒子の電荷、 λ はチェレンコフ光の波長、 α は微細構造定数である。つまり、単一電荷粒子が $\beta = 1$ で水中を1 cm 走ると、PMT の 有感波長領域 300 ~ 700 nm では、 $\theta = 42^{\circ}$ の方向に約 390 個の光子が放射される。

このチェレンコフ光は Super-K のタンクの壁に敷きつめた PMT 上でリング状のイメージを映すので、光が入射した各 PMT の信号の波高と時間情報を用いてチェレンコフリングを再構成し、粒子の生成点やエネルギー、運動方向を測定する。また、ミューオンによるチェレンコフ光は明瞭なリングになるのに対し、電子によるチェレンコフ光は電子が引き起こす電磁シャワーのため縁がぼやけた形のリングになるので、このリングの形の情報を用いることでミューオンと電子を識別する。



図 2.4: Tokai to Kamioka の位置関係。

振動パラメータは、

 $\frac{Super - K で観測されたニュートリノの数}{J - PARC で生成されたニュートリノの数}$ (2.6)

第2章 T2K 実験

によって測定される。

2.1.3 Off-axis ビーム

T2K 実験では off-axis ビームを用いる。これは、ビーム軸を検出器の方向からずらすこ とでエネルギースペクトル幅の狭いニュートリノビームを得るもので、実用化されるのは 世界で初めてである。



図 2.5: Off-axis ビームの概念図。

図 2.5 に示すように、グラファイト標的と Super-K とを結ぶ線とビーム軸とのなす角を off-axis 角 θ_{OA} と定義する。Off-axis 角はニュートリノビームのエネルギースペクトルの ピークが、ニュートリノ振動の効果が最もよく現れるエネルギー領域にくるように設定す る。T2K 実験では、 $\theta_{OA} = 2 \sim 2.5^{\circ}$ を用いる。

式 (1.16) より、 $\Delta m_{23}^2 = (1.9 \sim 3.0) \times 10^{-3} [\text{eV}^2]$ としたとき、T2K 実験(L=295 [km])においてニュートリノ振動の効果が最もよく現れるニュートリノエネルギーは、

$$E_{\nu} = 0.45 \sim 0.72 [\text{GeV}]$$
 (2.7)

である。

式 (2.2) のようにニュートリノは π 中間子の 2 体崩壊から生成されるので、ビーム軸か ら角 θ_{OA} の方向に出るニュートリノのエネルギーは、エネルギー - 運動量保存則から、

$$E_{\nu} = \frac{m_{\pi}^2 - m_{\mu}^2}{2(E_{\pi} - p_{\pi} \cos \theta_{\rm OA})}$$
(2.8)

ここで、 $m_{\pi}, p_{\pi}, E_{\pi}, m_{\mu}$ はそれぞれ π 中間子の質量、運動量、エネルギー、ミューオンの 質量を表している。式 (2.8)を p_{π} について微分すると、 E_{ν} は $\frac{p_{\pi}}{E_{\pi}} = \cos \theta_{\text{OA}}$ のとき最大値

$$E_{\nu}^{\max} = \frac{m_{\pi}^2 - m_{\mu}^2}{2E_{\pi}\sin^2\theta_{\rm OA}}$$
(2.9)

をとることが分かる。

式 (2.8) の $p_{\pi} \geq E_{\nu}$ の関係を $\theta_{OA} = 0, 2, 2.5^{\circ}$ について図示すると図 2.6 のようになる。 この図から、on-axis ビーム($\theta_{OA} = 0^{\circ}$)の場合には E_{ν} は p_{π} に比例するのに対し、off-axis ビーム($\theta_{OA} = 2, 2.5^{\circ}$)の場合にはそれぞれ $p_{\pi} = 4.0, 3.2$ [GeV/c] で最大値 0.86, 0.69 GeV をとり、 $p_{\pi} > 1$ GeV では E_{ν} は p_{π} にほとんどよらないので、ほぼ決まったエネルギーの ニュートリノビームを得ることができる。



図 2.6: off-axis 角 $\theta_{OA} = 0, 2, 2.5^{\circ}$ における π 中間子の運動量とニュートリノのエネルギー との関係。

2.2 実験の目的

2.2.1 電子ニュートリノ出現事象の探索

T2K 実験では、ミューオンニュートリノが電子ニュートリノに振動するモード($\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{e}$)の発見を目指す。以下に Super-K で観測される $\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{e}$ 振動のシグナルとバックグラウンドおよび探索の手法と感度について述べる。

 $u_{\mu}
ightarrow
u_{e}$ 振動のシグナル

 $\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{e}$ 振動の探索は、電子ニュートリノと酸素原子核との荷電カレント反応の検出によって行う。T2K 実験で用いるニュートリノのエネルギー領域($0.5 \sim 0.7 \text{ GeV}$)では、以下の荷電カレント準弾性散乱(CC-QE)が主要な反応である。

$$\nu_{\rm e} + {\rm n} \to {\rm e} + {\rm p} \tag{2.10}$$

第2章 T2K 実験

ここで、反跳陽子の運動量は水中でのチェレンコフ効果のしきい値よりも低いため、電子 による水チェレンコフ光のみ観測される。

バックグラウンド

電子ニュートリノ出現事象選別の後に残る主なバックグラウンドは、ミューオンニュート リノによる中性カレント π^0 生成反応 (ν_μ NC)事象と、ビーム中に混入する電子ニュート リノ (beam ν_e)による事象である。

 $\nu_{\mu}NC\pi^{0}$ 生成反応 $\nu_{\mu} + n \rightarrow \nu_{\mu} + n + \pi^{0}$ が起こったとき、 π^{0} 崩壊 $\pi^{0} \rightarrow \gamma\gamma$ からのガン マ線の1つが再構成されないと、その事象は単一電子事象と間違われて電子ニュートリノ 出現事象のバックグラウンドとなる。

また、ニュートリノビーム生成過程で、ミューオン崩壊 $\mu^+ \to e^+ + \nu_e + \overline{\nu}_\mu$ や K 中間子 崩壊 K⁺ → $\pi^0 + e^+ + \nu_e$, K⁰ → $\pi^- + e^+ + \nu_e$ によりビーム中に混入する電子ニュートリノ も電子ニュートリノ出現事象のバックグラウンドとなる。ビーム中のミューオンニュート リノに対する電子ニュートリノの割合は、エネルギースペクトルのピーク(0.7 GeV)で 約 0.4% である。

 $\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{e}$ 振動探索の感度

 5×10^{21} POT において、 $\Delta m^2 = 2.5 \times 10^{-3} [\text{eV}^2]$ 、 $\sin^2 2\theta_{13} = 0.1$ としたとき、モンテカ ルロシミュレーションによって得た全ての事象選択後に残るシグナル、バックグラウンド の事象数を表 2.2 に示す。

図 2.7(左)に、 5×10^{21} POT において予測される $\sin^2 2\theta_{13}$ の感度(90% C.L.)を示 す。ただし、 $\sin^2 2\theta_{23} = 1$ 、 $\delta = 0, \pi/2, -\pi/2, -\pi$ とし、バックグラウンド除去の系統誤 差(δ BG)を 10% と仮定した。 $\Delta m^2 \sim 2.5 \times 10^{-3}$ [eV²] において、 $\sin^2 2\theta_{13} = 0.008$ (90% C.L.)まで到達できる。

図 2.7(右)に、 $\Delta m^2 = 2.5 \times 10^{-3} [\text{eV}^2]$ 、 $\delta = 0$ において、 $\delta \text{BG} = 5, 10, 20\%$ としたと きの陽子照射時間に対する $\sin^2 2\theta_{13}$ の感度を 90% C.L.、 3σ について示す。5 年のランに 相当する 5×10^{21} POT において、バックグラウンド除去の系統誤差は 10% 程度に抑える 必要がある。

$ u_e$ シグナル	104
$ u_{\mu} \mathrm{NC}$ バックグラウンド	11
Beam ν_e バックグラウンド	14

表 2.2: 5×10²¹ POT において全事象選択後に Super-K で予測される事象数。



図 2.7: $\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{e}$ 振動探索の感度。

2.2.2 ミューオンニュートリノ消失の振動パラメータの精密測定

すでに確立されているミューオンニュートリノ消失の振動モードを用いて、振動パラメー タ(sin² 2 θ_{23} , Δm_{23}^2)の精密測定を目指す。以下に、ニュートリノ振動解析の手法とパラ メータの到達感度について述べる。

ミューオンニュートリノ消失のシグナル

ミューオンニュートリノが 295 km 飛行後、振動せずに残る確率 $P(\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{\mu})$ は、2 世代間 ニュートリノ振動($\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{\tau}$)において、

$$P(\nu_{\mu} \to \nu_{\mu}) = 1 - \sin^2 2\theta \sin^2 \left(\frac{1.27\Delta m^2 [\text{eV}^2] L[\text{km}]}{E_{\nu} [\text{GeV}]} \right)$$
(2.11)

と書ける。したがって、T2K 実験では、以下のような $\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{\tau}$ 振動シグナルが見える。

- ミューオンニュートリノ事象の欠損 T2Kのニュートリノエネルギーはタウニュートリノ荷電カレント反応のしきい値よ りも低いため、振動してできたタウニュートリノは Super-K で観測されない。した がって、 $\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{\tau}$ 振動によってミューオンニュートリノ事象の欠損が観測される。
 - エネルギースペクトルの歪み ミューオンニュートリノの飛行距離 *L* は 295 km で一定なので、 $P(\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{\mu})$ はニュー トリノのエネルギーの関数になる。したがって、 $\nu_{\mu} \rightarrow \nu_{\tau}$ 振動の効果は、Super-K

第2章 T2K 実験

で観測されるニュートリノのエネルギースペクトルが式(2.11)に従って歪む形で現 れる。

したがって、ND280 で測定したミューオンニュートリノ事象の数およびニュートリノのエ ネルギースペクトルを、モンテカルロシミュレーションで得た外挿関数で Super-K に外挿 し、それと Super-K での観測とを比較することで振動パラメータ($\sin^2 2\theta_{23}, \Delta m_{23}^2$)を測 定する。

ニュートリノのエネルギースペクトルは、主要な反応である式(2.10)の CC-QE 反応を 仮定して再構成する。この反応は2体散乱であり、ニュートリノのエネルギー E_{ν} はミュー オンの運動量 p_{μ} およびニュートリノビームの方向となす角 θ_{μ} を用いて次式のように計算 される。

$$E_{\nu}^{\rm rec} = \frac{(m_n - V)E_{\mu} - m_{\mu}^2/2 - \left((m_n - V)^2 - m_p^2\right)/2}{(m_n - V) - E_{\mu} + p_{\mu}\cos\theta_{\mu}}$$
(2.12)

ここで、 E_{ν} , m_{μ} はそれぞれミューオンのエネルギーと質量、 m_n , m_p は中性子、陽子の質量、Vは原子核のポテンシャルエネルギー(16 Oは 27 MeV)である。また、中性子のフェルミ運動は無視した。

バックグラウンド

ニュートリノのエネルギーは CC-QE 反応を仮定して再構成するので、次式のような CC-QE 以外の荷電カレント反応 (CC-nonQE) NC 反応はバックグラウンドとなる。

$$CC/NC1\pi$$
生成反応 : $\nu + N \rightarrow l + N' + \pi$ (2.13)

CC/NCコヒーレント\pi生成反応 :
$$\nu + {}^{16}O({}^{12}C) \rightarrow l + {}^{16}O({}^{12}C) + \pi$$
 (2.14)

CC/NC 深非弾性散乱 :
$$\nu + N \rightarrow \nu + N' + m\pi$$
 (2.15)

振動パラメータの到達感度

表 2.3 に、off-axis 角 $\theta_{OA} = 2.5^{\circ}$ 、 5×10^{21} POT のとき、モンテカルロシミュレーションに よって得た全ての事象選択後に残る CC-QE、CC-nonQE そして NC 反応の数を示す。

図 2.8(左)に、Super-K で予測される ν_{μ} 事象の E_{ν}^{rec} スペクトルを示す。ただし、 $\Delta m_{23}^2 = 2.7 \times 10^{-3} [\text{eV}^2]$ 、 $\sin^2 2\theta_{23} = 1.0$ を仮定した。網掛け部分は non-QE 反応によるものである。

図 2.8(右)に、ニュートリノ振動があるときとないときの E_{ν}^{rec} スペクトルの比を示す。 0.65GeV 付近に明瞭なディップが見られる。定性的には、ディップの深さが $\sin^2 2\theta_{23}$ 、位置 が Δm_{23}^2 に対応する。予想される統計誤差は、 $\sin^2 2\theta_{23}$ については 0.009、 Δm_{23}^2 について は 5 × 10⁻⁵ eV² である。

$\Delta m_{23}^2 (\mathrm{eV}^2)$	CC-QE	CC-nonQE	NC	全 ν_{μ} 事象
振動なし	$3,\!620$	1,089	96	4,805
$2.0 imes 10^{-3}$	933	607	96	$1,\!636$
2.3×10^{-3}	723	525	96	$1,\!344$
$2.7 imes 10^{-3}$	681	446	96	1,223
3.0×10^{-3}	800	414	96	1,310

表 2.3: 5×10^{21} POT において Super-K で予測される ν_{μ} 事象数。 $\sin^2 2\theta_{23} = 1.0$, $\sin^2 2\theta_{13} = 0.0$ とした。



図 2.8: (左) Super-K で予想される ν_{μ} 事象の E_{ν}^{rec} スペクトル。 (右) ニュートリノ振動があるきとないときの E_{ν}^{rec} スペクトルの比。

図 2.9 に、真の Δm_{23}^2 の関数として各振動パラメータの統計誤差を示す。ただし、 $\sin^2 2\theta_{23} = 1.0$ を仮定した。

図 2.10 に、系統誤差の影響を示す。破線は 5×10^{21} POT のときの系統誤差(1σ)で、 以下の 4 つの系統誤差について考慮した。

- *v*_µ事象数規格化の不定性
 ND280から Super-K に外挿する際の *v*_µ事象数の誤差。赤線は事象数の規格化が 10%
 ずれたとき振動パラメータにかかる系統的バイアスを示す。
- non-QE/QE 比の不定性
 non-QE と QE の反応断面積の比の誤差。Super-K で予測されるニュートリノのエネ
 ルギースペクトルの形に影響する。緑線は non-QE/QE 比が 20% ずれたとき振動パ

第2章 T2K 実験



図 2.9: 真の Δm_{23}^2 の関数として各振動パラメータの統計誤差。 $\sin^2 2\theta_{23} = 1.0$ を仮定した。



図 2.10: 振動パラメータの系統誤差。赤線は ν_{μ} 事象数規格化が 10% 変化したとき、緑線 は non-QE/QE 比が 20% 変化したとき、青線はエネルギースケールが 4% 変化したとき、 ピンク線はスペクトルの形に 20% の線形な歪みを加えたとき、水色線はスペクトルの幅が 10% 変化したときを示す。破線は 5 × 10²¹ POT のとき 1 σ の系統誤差を示す。

ラメータにかかる系統的バイアスを示す。

エネルギースケールの不定性
 エネルギースケールの誤差。Super-Kで予測されるニュートリノのエネルギースペクトルの形に影響する。青線はエネルギースケールが4%ずれたとき振動パラメータに

かかる系統的バイアスを示す。

 エネルギースペクトルの形の不定性 Super-Kで予測されるニュートリノのエネルギースペクトルの形に対する誤差。ピン ク線は1+0.2(1 – E_ν)の20%の線形な歪みを加えたとき振動パラメータにかかる系 統的バイアスを示す。この変化は2つのハドロン生成モデルMARSとFLUKAで予 測されるスペクトルの違いに対応する。水色線はスペクトルの幅が10%変化したと き振動パラメータにかかる系統的バイアスを示す。

系統誤差を統計誤差よりも小さく抑えるためには、上の不定性についてそれぞれ、

- ν_μ 事象数規格化の不定性: 5% 以下
- non-QE/QE 比の不定性: 5~10% 以下
- エネルギースケールの不定性:2%以下
- エネルギースペクトルの線形な歪みの不定性: 20% 以下
- エネルギースペクトルの幅の不定性:10%以下

に抑える必要がある。

2.3 実験計画

J-PARC は現在建設中で、2008 年 10 月に施設稼動予定である。ミューオンモニターの インストールは 2008 年 12 月に行い、T2K 実験は 2009 年 4 月に物理ランを開始する。

まず、デザイン値の1%強度(7.5 kW)のビームで、プロトンビームモニターやミュー オンモニターを用いてニュートリノビームを調整する。

そして、最初の1年間は100 kW のビーム強度で測定を行い、ニュートリノビームについ て詳細に研究する。ここで 2×10^{20} POT のデータ量が見込まれるが、その最初の1年のラン でも、電子ニュートリノ出現事象については、 $\Delta m_{23}^2 = 2.5\times10^{-3} [\text{eV}^2]$ 、 $\sin^2 2\theta_{13} = 0.1$ のと き、シグナルが $4\sim5$ 事象、バックグラウンドが ~1 事象期待できる。また、ミューオンニュー トリノ消失の振動パラメータについては、 1σ で $\delta(\sin^2 2\theta_{23}) = 0.03$ 、 $\delta(\Delta m_{23}^2) = 1.6\times10^{-4}$ まで到達できる。その後、4年間のランで 5×10^{21} POT を目指し、前節で述べたニュート リノ振動の研究を行う。

2.4 ミューオンモニターに対する物理的要請

T2K 実験においては、ニュートリノビームが Super-K の方向に飛んでいるという確証 を得るために、ニュートリノビームの方向を正確に測定することが重要である。さらに、 ミューオンニュートリノ消失パラメータを第2.2.2 小節で述べた精度で測定するには、ニュー トリノビームの方向を精密に1 mrad 以上の精度で測定する必要がある。その役割を果た すのがミューオンモニターである。

ミューオンモニターは、

 ・親の π 中間子からニュートリノとともに出てくるミューオンの位置プロファイルを 測定することで、ニュートリノビームの方向と強度を間接的にモニターする装置

である。

ニュートリノビームの方向を 1 mrad 以上の精度で測定することは、ミューオンモニター においてミューオンプロファイルの中心を 11 cm 以上の精度で測定することに対応する。 陽子標的からミューオンモニターまでの距離が 110 m である。そこで、ミューオンモニター に要求するプロファイル中心の測定精度を 3 cm とし、より精度良く確証の得られる測定 を目指す。

ミューオンモニターは大強度のミューオンを測定するので、バンチごとにプロファイル を測定することができる。このように、リアルタイムにニュートリノビームの方向をモニ ターすることができるのは、T2K実験の測定器の中ではミューオンモニターだけである。 したがって、ミューオンモニターはT2K実験において欠かせない要素の1つで、ミューオ ンモニターが止まってしまった場合には、T2K実験を止める必要がある。

また、ミューオンモニターは電磁ホーンのアラインメントや電流量、また標的に照射す る陽子ビームのずれにも感度があるので、通常ランのみならずコミッショニングにおいて もビーム調整の上で重要な役割を担う。

よって、ミューオンモニターは以下のような要請を満たさなければならない。

- ニュートリノビームの方向を1 mrad 以上の精度でモニターするため、ミューオンの プロファイル中心を3 cm 以上の精度で測定する
- バンチごとにプロファイルを測定する
- 5年間メンテナンスフリーで安定に動作し続ける
- コミッショニング時の1% 強度のビームも同じ精度で測定できる

第3章 T2K ミューオンモニターへの物理的 要請と設計

ミューオンモニターのデザインを考える上で、ミューオンモニターにおけるビームの性 質を知ることが重要である。そこで本章ではまず、モンテカルロシミュレーションによる ミューオンモニターにくる粒子の数や位置プロファイルの見積もり、またミューオンモニ ターの副次的機能について説明する。そしてミューオンモニターに用いる検出器の選定、 検出器に求められる性能の見積もりについて述べる。

3.1 T2Kビームラインシミュレーション

ミューオンモニターでのビームの性質を調べるために、まず、T2K ビームラインシミュ レーションプログラム (jnubeam)を使ってのモンテカルロシミュレーションをを紹介す る。jnubeam は T2K ビームラインにおいてニュートリノビームを生成する過程のシミュ レーションを行うプログラムで、GEANT3を用いて作られている。

図 3.1 が T2K ビームラインのジオメトリである。陽子ビームをコリメータを通して標的 に照射する過程から、ダンプ直後のミューオンモニターへの粒子輸送までをシミュレート している。陽子ビームはグラファイト標的に衝突し、2 次粒子を生成する。生成した π 中間 子は 3 台の電磁ホーンによって収束され、93 m 長の崩壊トンネル中で崩壊してニュートリ ノとなる。その崩壊から同時に生成されるミューオンや、崩壊せずに残った π 中間子など のハドロンは、崩壊トンネル直後のビームダンプで吸収される。ビームダンプは主にグラ ファイト(315 cm 厚) 鉄(250 cm 厚) コンクリート(100 cm 厚)で構成される。なお、 このビームダンプの物質量では、ビームダンプを通過できるミューオンの運動量のしきい 値は 5 GeV/c である。このしきい値は、陽子ビームの照射位置がずれたときに、ミューオ ンモニターでプロファイル中心のずれがもっともよく見え、かつミューオンモニターにお ける中性子のフラックスが小さくなるように設定してある。

本節では、ビームダンプを通過してきた粒子のフラックス、エネルギー分布、位置プロ ファイルの見積もり、陽子ビームの標的照射位置がずれたときのミューオンプロファイル の変化について評価を述べる。

用いたシミュレーションのパラメータを表 3.1 に示す。

第3章 T2K ミューオンモニターへの物理的要請と設計



図 3.1: T2K ニュートリノビームラインのジオメトリ(横から見た断面図)。左端から、標的施設(コリメータ、グラファイト標的、電磁ホーン)崩壊トンネル、ビームダンプ、ミューオンピット。標的施設、崩壊トンネル、ビームダンプ周囲は、冷却のためへリウムガスで満たれている。



図 3.2: 標的施設(横から見た断面図)。コリメータを通して陽子ビームをグラファイト標的に照射し、生成した π 中間子を 3 台の電磁ホーンで収束させる。

3.1. T2K ビームラインシミュレーション



図 3.3: ビームダンプとミューオンピット(上は横から、下は真上から見た断面図)。

第3章 T2K ミューオンモニターへの物理的要請と設計

off-axis 角	2.5°
陽子エネルギー	$40.9~{\rm GeV}$
陽子ビーム径 σ	$0.6~\mathrm{cm}$
電磁ホーン電流	320 kA
カットオフ運動エネルギー	
ガンマ線	$10 \ \mathrm{keV}$
電子	$10 \ \mathrm{keV}$
中性ハドロン	$10 \ \mathrm{keV}$
荷電ハドロン	$1 { m MeV}$
ミューオン	$5 { m MeV}$

表 3.1: T2K ビームラインシミュレーションのパラメータ。

3.1.1 ミューオンモニターにおける粒子のフラックス、位置プロファイル、エネ ルギー分布

シミュレーションによって得られたミューオンモニターにおける各粒子のフラックス、位置プロファイル、エネルギー分布をそれぞれ表 3.2、図 3.4、図 3.5 に示す。モンテカルロの統計は 3.2×10⁶ POT で、フラックスと位置プロファイルについてはこれを 1 spill 当たりの統計(3.3×10¹⁴ POT)にスケールしてある。

ミューオンモニターにおける全荷電粒子数は、ビーム軸上で1.33×10⁸ particles/cm²/spill と見積もられた。ミューオンピット全体で見ると、9.53×10¹² particles/spill となる。その 内、ミューオンが占める割合が84.0%、電子の占める割合が15.7%である。したがって、 ミューオンモニターで観測するのはほとんどミューオンと電子である。また、図3.4を見る と、荷電粒子の位置プロファイルはビーム軸(0 cm, -22 cm)を中心にガウシアンに近い分 布、中性子のプロファイルは一様な分布をしていることが分かる。したがって、ミューオ ンモニターにおいて全荷電粒子のプロファイルを測定することは、ミューオンのプロファ イルを測定することと同値である。

全荷電粒子の位置プロファイル(図3.4 左下)を2次元ガウシアン

$$f(x,y) = A \exp\left(-\frac{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}{2\sigma^2}\right)$$
(3.1)

でフィットしたときのフィットパラメータを表 3.3 に示す。荷電粒子のプロファイルは、σ≈1 m の分布をしていることが分かった。



図 3.4: ミューオンモニターにおける各粒子の位置プロファイル。*x* は水平方向、*y* は鉛直 方向を表す。



図 3.5: ミューオンモニターにおける各粒子のエネルギー分布。

3.1. T2K ビームラインシミュレーション

$1.33{ imes}10^8$
$1.19{\times}10^8$
$1.75{\times}10^7$
$5.16{\times}10^5$
$7.73{\times}10^5$
$7.73{\times}10^5$
$3.35{\times}10^6$
$8.02{\times}10^7$

表 3.2: ミューオンモニターにおけるビーム軸の粒子のフラックス [/cm²/spill]。

$x_0[\mathrm{cm}]$	$0.317 {\pm} 0.298$
$y_0[\mathrm{cm}]$	$-22.77 {\pm} 0.54$
$\sigma[{\rm cm}]$	$103.0 {\pm} 0.2$

表 3.3: ミューオンモニターにおける全荷電粒子のプロファイルパラメータのベストフィット。

3.1.2 陽子ビーム照射位置に対する感度

標的に照射する陽子ビームの位置がずれることが、ニュートリノビームの方向がずれる 主な原因となる。そこで、陽子ビームの照射位置がずれたとき、それがミューオンモニター においてどのように観測されるかを調べる。ここでは簡単のため、水平方向(x方向)にず れた場合についてのみ考える。陽子ビームの照射位置の標的中心からのずれを δx として、 $\delta x = 0, 1, 5$ mm についてシミュレーションを行う。なお、モンテカルロの統計は 1.0×10^6 POT である。各 δx について得られた全荷電粒子の x プロファイルを図 3.6 に示す。各プ ロファイルの-75 $\leq x \leq$ 75[cm] の領域をガウシアンでフィットして(図赤線)、プロファイ ル中心 x_0 を求める。 $\delta x = c x_0$ との関係を同図(右下)に示す。

図 3.6(右下)の3 点を直線でフィットすると、傾きは-42.2 となる。よって、陽子ビー ムの照射位置のずれは、ミューオンモニターにおいて約 40 倍に増幅されて見えることが分 かる。すなわち、ミューオンモニターでプロファイル中心のずれを測定することで、陽子 ビームの照射位置のずれを約 40 倍の感度で知ることができる。さらにミューオンモニター はバンチごとにプロファイルを測定するので、そのずれの情報をすぐさま陽子ビームライ ンにフィードバックすることができる。



図 3.6: ミューオンモニターにおける全荷電粒子の x プロファイル。 δx は、陽子ビームの 照射位置のずれを表す。

3.1.3 ミューオンモニターのサイズ

前節のシミュレーション結果より、ミューオンプロファイルの中心がミューオンモニター の中心にあるとき、プロファイルを 2 次元ガウシアンでフィットしてプロファイル中心を 求めるのに必要な領域は、 $\pm 50 \text{ cm}$ であることが分かった。しかし、陽子ビームの照射位 置が標的中心から 5 mm ずれるとミューオンモニターでのプロファイル中心は約 20 cm ず れるが、そのときでもプロファイル中心の位置をおさえるためには、さらに 20 cm 以上領 域を広げる必要がある。よって、 $150 \times 150 \text{ cm}^2$ の領域をミューオンモニターの覆う領域と する。

3.2 ミューオンモニターに用いる検出器

シミュレーションによって、ミューオンモニターは 1.3×10⁸ particles/cm²/spill の大強 度のビームを測定しなければならないことが分かった。さらに、第 2.4 節で述べたように、 ミューオンモニターは、その高放射線環境下でも常に安定して動作していなければならな い。そこで、2 つの独立なシステムを用いて冗長性、重複性のある測定を行う。1 つには シリコン PIN フォトダイオードと CVD(Chemical Vapor Deposition)ダイヤモンド検出 器、もう一方には平行平板型イオンチェンバーを採用した。

以下に、選定の根拠となる各検出器の特徴について述べる。

3.2.1 シリコン PIN フォトダイオード

シリコン半導体検出器は、高エネルギー実験において広く使用されている検出器である。 また、先のK2K実験において、ミューオンモニターとして終始安定に動作していたとい う実績がある。しかし、T2Kミューオンモニターでは大強度のビームを測定することにな るので、使用においてはシリコンの放射線損傷が問題となる。よって、ビーム強度の弱い ビームコミッショニング時(通常ランの1%のビーム強度) あるいは、最初の1年(通常 ランの10%のビーム強度)で使用することを考える。

3.2.2 CVD ダイヤモンド 検出器

CVDダイヤモンド検出器は、近年開発された放射線検出器である。ダイヤモンドは絶縁 体であるが、動作原理は半導体検出器と同じなので、半導体検出器(あるいは固体検出器) として分類され、一般の半導体検出器と同じような応答を示す。そしてもっとも重要な特 徴は、半導体検出器よりも非常に優れた耐放射線性を持つということである。その例とし 第3章 T2K ミューオンモニターへの物理的要請と設計

て、1×10¹⁵/cm²の陽子(24 GeV/c)を照射した測定で、シリコン検出器は放射線損傷に より応答しなくなったのに対し、CVDダイヤモンド検出器のシグナルには変化が見られな かったという報告がある。

3.2.3 平行平板型イオンチェンバー

平行平板型イオンチェンバーは、ガス容器の中で2枚の電極平板を、ある一定の間隔 (ギャップ)を隔てて互いに平行に並べ、電極間ギャップに電圧をかけて信号を読み出す検 出器である。これは以下に挙げるように、第2.4節で述べたミューオンモニターに対する 物理的要請に合う。

- 単純な構造で、動作で壊れにくい。
- ギャップ間の電場が一様なので、電子のドリフト速度を調整しやすい。すなわち、シ グナルを増幅させずに読み出せるので、大強度のビームでも測定可能。
- ギャップを小さくすることで、大強度のビームに対しても高い収集効率および速い応答が可能。
- 使用するガスを適切に選ぶことで、容易に必要な応答を得ることができる。

イオンチェンバーに用いるガスの候補は、ヘリウムとアルゴンである。アルゴンは全比電 離がヘリウムの約10倍あるので、この2種類のガスを使い分けることでより広い領域の強 度のビームを測定することができる。すなわち、通常のランではヘリウムを使用し、ビー ムコミッショニングのときなどビーム強度が通常ランの1~10%のときにはアルゴンを使 用する。

3.3 シミュレーションによるミューオンモニターのデザイン

本節では、ミューオンモニターにおける検出器の配置を考える。そのために、放射線損 傷について、ミューオンモニターに対する物理的要請についてのシミュレーションを行う。

3.3.1 放射線損傷

前節のシミュレーションにより、ミューオンモニターには 1.3×10⁸ particles/cm²/spill という大強度のビームがくることが分かった。このような高放射線環境下においては、シ ステムを設計する上で、用いる検出器やその部品などの放射線損傷を十分考慮しなくては ならない。 3.3. シミュレーションによるミューオンモニターのデザイン

また、半導体検出器の放射線損傷には電離による表面欠損と置換によるバルク欠損があるが、ここでは T2K ミューオンモニターでの動作に重大な影響を与えるバルク欠損についても述べる。

点欠損

点欠損は、結晶格子の周期性からの "0次元 "の乱れである。この点欠損が集結すると、熱 的、電気的伝導率やキャリアの移動度などが変化し、半導体検出器の動作に大きく影響し てくる。点欠損の模式図を図 3.7 に示す。点欠損があると、バンドギャップに新たなエネル ギー準位が生まれるので、キャリアの捕獲や再結合が起こり、シグナルの減少につながる。



図 3.7: 点欠損の模式図。(a) 格子間侵入原子。(b) 格子欠如。(c),(d) 侵入置換。(e) 自己格 子間侵入。

バルク欠損

物質に粒子が入射すると、結晶を構成する原子にエネルギーが与えられるが、そのエネル ギーが十分大きいとき、その原子は結晶格子から弾き飛ばされて PKA (Primary Knockon Atom)となる。そしてその PKA が別の原子を弾き飛ばして新たな SKA (Secondary Knock-on Atom)をつくることもある。よって PKA、SKA は格子欠如型、自己格子間侵 入型の点欠損となる。PKA、SKA の連鎖が進むと、点欠損は集団欠損となって現れる。

こうした欠損は非電離相互作用によって生じ、バルクの中に現れる。バルク欠損は格子 の配列を乱すので不可逆であり、放射線損傷として永久に残り続ける。 第3章 T2K ミューオンモニターへの物理的要請と設計

NIEL スケーリング

シリコンなどの固体検出器を用いる場合、放射線損傷による問題は主に、バルク欠損によ り引き起こされ、観測される検出器の劣化の度合いは、放射線量や粒子の種類、エネルギー に依存する。バルク損傷は PKA によって引き起こされるものだと仮定すると損傷に関係 するのは、物質と粒子との一番最初の相互作用である。その最初の相互作用を表す物理量 が NIEL (Non Ionizing Energy Loss)で、過去の測定から、NIEL によるスケーリング は多くの物質と粒子について信頼できるものと考えられている。そして関連する損傷関数 *EDK* (Energy spectrum avaraged Displacement KERMA (Kinetic Energy Released in MAtter))の値は、広いエネルギー範囲にわたって異なるエネルギーをもつ様々な粒子に より引き起こされる放射線損傷の効果の違いを規格化するのに有用である。

NIEL スケーリングにより、あるスペクトル分布 $\phi(E)$ をもつ放射線量 Φ の任意のビームと同等の放射線損傷を引き起こす、1MeV 等価中性子線量 Φ_{eq}^{1MeV} を定義できる。

$$\Phi_{\rm eq}^{\rm 1MeV} = \kappa \Phi \tag{3.2}$$

κはハードネスパラメータと呼ばれ、EDKを用いて次式で定義される。

$$\kappa = \frac{EDK}{EDK(1\text{MeV})} \tag{3.3}$$

EDKは、入射粒子のエネルギーEについての損傷関数D(E)のエネルギースペクトル平均である。

$$EDK = \frac{\int D(E)\phi(E)dE}{\int \phi(E)dE}$$
(3.4)

$$D(E) = \sum_{k} \sigma_k(E) \int dE_R f_k(E, E_R) P(E_R)$$
(3.5)

ここで、 σ_k は反応 k の断面積、 $f_k(E, E_R)$ は反応 k において入射粒子がエネルギー E_R の反跳粒子をつくり出す確率、 $P(E_R)$ は分配関数(置換に費やす反跳エネルギーの割合)である。また、EDK(1 MeV) はエネルギー 1 MeV の中性子についての損傷関数で、

$$EDK(1MeV) = D_n(1MeV) = 95[MeVmb]$$
(3.6)

である。

一方、NIEL は次式で計算される。

$$\left. \frac{dE}{dx} \right|_{n.i.} = N \sum_{Z,A} \int_{E_R^{\min}}^{E_R^{\max}} \frac{d\sigma}{dE_R} P(E_R) dE_R \tag{3.7}$$

ここで、 $N = \frac{N_A}{A}\rho$ で、Z, A は物質の原子番号と質量数、 N_A はアボガドロ定数、 E_R^{\max} は運動学的エネルギー制限、 E_R^{\min} は格子から原子を押しのけるのに必要な最小エネルギーに

対応するカットオフエネルギーである。式 (3.7) の Z,A についての和は、式 (3.5) で全て の反応 k について和をとることに対応するので、NIEL と D(E) には以下の関係式が成り 立つ。

$$NIEL = \left. \frac{dE}{d(\rho x)} \right|_{n.i.} = \frac{N_A}{A} D(E)$$
(3.8)

したがって、A=28.086 [g/mol]のシリコンについては以下の対応がつく。

$$100[MeVmb] = 2.144[keVcm^2/g]$$
 (3.9)

図3.8に、入射粒子のエネルギーに対するシリコンの損傷関数を示す。

前節のビームラインシミュレーションで得られたミューオンモニターにおける各粒子のス ペクトル分布 $\phi(E)$ (図 3.5)に、図 3.8の損傷関数 D(E)/95MeVmb をかけ、式 (3.3)、式 (3.4) からハードネスパラメータを求めた。そして式 (3.2) より、ミューオンモニターにおけ る 1MeV 等価中性子線量を見積もった。ミューオンピットのビーム軸上にくる粒子のハー ドネスパラメータ κ 、線量 Φ 、1MeV 等価中性子線量 Φ_{eq}^{1MeV} を表 3.4 にまとめた。ミューオ ンモニターにくるビームの全 1MeV 等価中性子線量は 9.7×10⁶ 1MeV neutrons/cm²/spill と見積もられた。

24 GeV/c の陽子を 1×10^{15} /cm² 照射した結果、シリコン検出器のシグナルは見えなくな り、CVDダイヤモンド検出器のシグナルに減少は見られなかったという測定から、NIEL ス ケーリングを用いて、T2K ミューオンモニターにおけるシリコン PIN フォトダイオードおよ び CVDダイヤモンド検出器の寿命を見積もることができる。24 GeV/c の陽子のハードネス パラメータは $\kappa \sim 1$ であるから、 1×10^{15} protons/cm² は 1×10^{15} 1MeV neutrons/cm²/spill に等しい。

したがって、T2K ミューオンモニターにおいては、 1.03×10^8 spill≈4000 日間、CVDダイヤモンド検出器はシグナルの減少なしに動作可能であると考えられる。一方、シリコン検出器は ~ 2×10^{12} 1MeV neutrons/cm² で型反転(p型がn型に変わる現象)が起こるので、 2.06×10^5 spill≈8 日間で動作しなくなると予想される。(1日~25000 spill)

		e^{\pm}	μ^{\pm}	n	р	π
κ		0.07	0.08	1	1.51	0.64
Φ	$[\mathrm{cm}^2/\mathrm{spill}]$	$1.3{ imes}10^7$	$8.6{ imes}10^7$	$1.9{ imes}10^6$	$2.2{\times}10^3$	$2.1{ imes}10^4$
$\Phi_{\rm eq}^{1{ m MeV}}$	$[\mathrm{cm}^2/\mathrm{spill}]$	$9.3{ imes}10^5$	$6.9{ imes}10^6$	$1.9{ imes}10^6$	$3.3{ imes}10^3$	1.4×10^4

表 3.4: ミューオンピットのビーム軸上にくる粒子のハードネスパラメータ κ 、線量 Φ 、 1MeV 等価中性子線量 Φ_{eq}^{1MeV} 。Total: 9.7×10^6 1MeV neutrons/cm²/spill。



図 3.8: シリコンの損傷関数。

吸収線量の見積り

ビームラインシミュレーションにおいて、ミューオンピットのビーム軸上に様々な物質を 置き、その吸収線量を求める。その結果を表 3.5 に示す。なお、このときのモンテカルロの 統計は 1.4×10⁶ POT で、表 3.5 に示した値はモンテカルロで得られた量を1年(100日) 当たりの量(8.1×10²⁰ POT)にスケールしたものである。

シミュレーションにより、吸収線量はあまり物質の種類によらず~60 kGy/year である ことが分かった。この値は、ミューオンモニターに用いる材料を選定する際に有用である。 特に、ケーブルやコネクタの絶縁材料は、この放射線量でも使用可能なものを選ぶ必要が ある。また、残留放射能をできるだけ抑えるために、放射化しにくい材料を使用すること も重要である。

3.3.2 検出器の配置と系統誤差の評価

ミューオンモニターの検出器の配置として、図 3.9(上)のようなものを考える。ここでは、CVDダイヤモンド検出器についてのみ述べる。

CVD はダイヤモンド検出器は高価であるため、使用するチャンネル数はできるだけ少な
	吸収線量 [kGy/year]
シリコン	56.2
ダイヤモンド	58.3
ヘリウムガス	75.4
アルゴンガス	61.1
アルミニウム	62.5
アルミナセラミック	63.0
エポキシ樹脂	72.1
SUS304	96.0
空気	44.5

3.3. シミュレーションによるミューオンモニターのデザイン

表 3.5: ミューオンピットのビーム軸上に置かれた物質の、1年(100日)のラン(8.1×10²⁰ POT)当たりの吸収線量。

くしたい。そこで、図の(A)(B)(C)のような3つの配置を考案した。(A)は5×5 のマスに交互に並べるもので、チャンネル数は13である。(B)は5×5のマスに放射状に 並べるもので、チャンネル数は17である。そして(C)は5×5のマスをすべて埋めるもの で、チャンネル数は25である。

検出器の配置において、ミューオンモニターに用いる検出器のチャンネルごとの測定誤 差が、再構成するプロファイル中心の決定精度にどのような影響を及ぼすのかを、以下の ようなトイモンテカルロシミュレーションで見積もる。

- 1. 検出器の測定誤差を s とする。
- 2. 検出器の配置を決める。
- 3. ビームラインシミュレーションで得た荷電粒子のプロファイルを、真のプロファイル $F_{\text{true}}(x, y)$ とする。
- 4. 検出器 *i* の位置(x_i, y_i) での応答を $F_i = (1 + \delta_i) F_{\text{true}}(x_i, y_i)$ とする。なお、 δ_i は標 準偏差 *s* の正規分布に従うものとし、試行の度ランダムに与える。
- 5. 各検出器の F_i からプロファイルを再構成し、それを $F_{rec}(x, y)$ とする。
- 6. F_{true} からの F_{rec} のプロファイル中心のずれ drを求める。
- 7. 4~6の試行を 10000 回繰り返す。
- 8. 得られた dr の分布で、 $\sigma(dr)$ をプロファイル再構成における系統誤差とする。

第3章 T2K ミューオンモニターへの物理的要請と設計

シミュレーションによって得られた検出器の測定誤差 s とプロファイル再構成の系統誤 $\tilde{\sigma}(dr)$ の関係を図 3.9(下)に示す。

ミューオンモニターに用いる検出器に対する要請は、 $\sigma(dr)=3$ cm である。第5章で述 べるビームテストによる検出器の性能評価により、その要請を満たすよう図 3.9(下)のシ ミュレーション結果に基づいて、検出器の配置とチャンネル数を決定する。



図 3.9: (上)検出器の配置。後ろの破線は、ミューオンモニターが覆う 150×150 cm² の 領域を示す。 (下)検出器の測定誤差 s とプロファイル再構成の系統誤差 $\delta(dr)$ の関係。

第4章 CVDダイヤモンド検出器

本章では、T2K ミューオンモニターに用いる CVD ダイヤモンド 検出器についての仕様、 性質、生成方法、動作原理について述べる。

4.1 CVDダイヤモンド検出器の仕様

本研究では、CERN RD42 で開発されたサンプルについてテストを行った。そのサンプ ルの仕様を表 4.1 に示す。図 4.1 はテストサンプルの写真である。



図 4.1: 本研究で用いる CVD ダイヤモンド検出器の写真。

有感面積	$9.5 \times 9.5 \text{ mm}^2$
ウェハーの厚さ	$500~\mu{ m m}$
最大許容印加電圧	500 V

表 4.1: 本研究で用いる CVD ダイヤモンド検出器の仕様。

4.2 CVDダイヤモンドの性質

4.2.1 ダイヤモンドの物理的性質

表4.2に、ダイヤモンドとシリコンの物理的性質を示す。

	ダイヤモンド	シリコン
陽子数 Z	6	14
密度 [g/cm ³]	3.515	2.329
結合エネルギー [eV/atom]	7.37	4.63
バンドギャップ [eV]	5.48	1.124
電子移動度 $[cm^2/V$ ·sec.]	1800	1350
正孔移動度 $[cm^2/V$ ·sec.]	1200	440
電子-正孔対生成エネルギー [eV]	13	3.6
格子定数	3.57	5.43
比誘電率	5.7	11.9
熱膨張係数 $[\mathrm{K}^{-1}]$	0.8×10^{-6}	$2.6{\times}10^{-6}$
熱伝導係数 [W/cm·K]	20	1.5
放射長 [cm]	12.03	9.4
絶縁破壊電界 [V/cm]	10^{7}	$3{\times}10^5$
抵抗率 [Ω·cm]	10^{13}	$20{ imes}10^3$
融点 [°C]	4000	1420
平均電子-正孔対生成数 $[pair/100\mu m]$	3600	9000

表 4.2: ダイヤモンドとシリコンの代表的な物理的性質(標準状態における値)。

4.2.2 人工ダイヤモンドの生成方法

次に、人工ダイヤモンドの生成方法について、いくつか簡単に紹介する。

• 高圧高温合成(HP/HT)法

グラファイト、カーボンを原料として、5万気圧、1300°C以上の環境でダイヤモンドを合成する方法。結晶構造は、大型単結晶となる。

衝撃法

爆薬による衝撃でダイヤモンドを合成する方法。微細な研磨粒ができる。

• 気相合成法(蒸着成長製法)

4.2. CVD ダイヤモンドの性質

炭素を含む原料ガスをプラズマなどの高温状態にして、1000°C以下の基 板に析出させる方法。薄膜コーティング、板状の多結晶体ができる。

これらの中で、本研究で用いた CVD ダイヤモンドに関係する生成方法は蒸着成長製法で あり、これには PVD 法と CVD 法がある。

• PVD (Physical Vapor Deposition) 成長製法

原料を蒸発、昇華などの方法で気体にし、これから結晶を成長させる。

• CVD (Chemical Vapor Deposition) 成長製法

成長させたい物質を含む化学物気体を、熱、プラズマなどにより分解し、 結晶を成長させる。

CVD 成長製法により、高純度で面積の人工ダイヤモンドを安価に製造することが可能と なり、ダイヤモンドを検出器として利用することが実用的になった。さらにダイヤモンド は耐放射線性に優れていることから、高エネルギー物理実験においては、シリコンなど従 来の半導体検出器に代わり得るものとして期待されている。

以下、CVDダイヤモンドについて詳しく述べていく。

CVD 成長製法

ー般に人工ダイヤモンドは、高温(>1000°C)高圧(>10⁵ atm)の液体から作られるが、 CVDダイヤモンドは低温(<1000°C)低圧(≈ 0.1 atm)のガスを用いた非平衡過程から 作られる。

CVDダイヤモンドは炭素、水素、酸素の混合ガスを入れた図 4.2 のような炉の中で、次のような過程を経て成長する。

- 1. CH₄ のようなガスから炭素が分離して、グラファイトやダイヤモンドの形で 600°C から 1000°C に熱せられた基板の上に堆積する。
- 2. ダイヤモンドよりもグラファイトのほうが速く堆積するので、水素原子や酸素原子、 OH 遊離基によってグラファイトを剥がしていく。
- 一方、ダイヤモンドはそれらには不感であるので、徐々に堆積していき大きな結晶となる。

CVD 成長の過程は、核形成と結晶成長の2つに分けられる。核形成は主にシリコンなどの基板上で起こり、そこからダイヤモンドの結晶が成長していく。よって、CVDダイヤモ

ンドは天然ダイヤモンドと違い、必然的に多結晶構造となる。また、CVDダイヤモンドは、図 4.3 のように基板側の核形成面と逆側の成長面とで結晶の大きさが異なるのが特徴である。

このように、CVDダイヤモンドは、その結晶の1つひとつ(結晶粒)が形、大きさとも 異なるため、キャリアのドリフト速度は場所によって変化し得る。また、結晶粒間が欠損 となりエネルギーギャップに非常に多くの不純中心をつくるので、一般に CVDダイヤモン ド検出器の電荷収集間隔はウェハーの厚さよりも小さくなる。



図 4.2: 蒸着炉の概観。

エネルギーバンド 構造

図 4.4 に、ダイヤモンドのエネルギーバンド構造を示す。ダイヤモンドは、バンドギャップ $E_g=5.48$ [eV] の絶縁体である。

4.3 CVDダイヤモンド検出器の動作原理

ダイヤモンド検出器の動作原理を図式化したものを図 4.5 に示す。ダイヤモンドは *E_g*=5.48[eV] の絶縁体であるが、放射線検出器として用いる場合の動作原理は半導体検出器と同じであ る。したがって、ダイヤモンド検出器は半導体検出器として分類される。

電荷収集間隔



図 4.3: CVD ダイヤモンドサンプルの電子顕微鏡写真。(左)成長面。(右)基板面(核形 成面)。



図 4.4: ダイヤモンドのエネルギーバンド構造。下側の曲線は価電子帯(VB)の最高エネル ギー、上側の曲線が伝導帯(CB)の最低エネルギーを示す。その間がバンドギャップ(BG) である。 Γ は $\vec{k} = \vec{0}$ に対応する。



図 4.5: ダイヤモンド検出器の動作原理。

CVDダイヤモンド検出器のウェハーサンプルの性能を評価する指標として、電荷収集間隔 *ā*が用いられる。

ダイヤモンドにバイアス電圧 V(E = -dV/dx) をかけたとき、電子、ホールがダイヤモンド中を移動できる距離をそれぞれ d_e 、 d_h とすると、

$$\begin{cases} d_e = \mu_e \tau_e E \\ d_h = \mu_h \tau_h E \end{cases}$$
(4.1)

ここで、 τ_e, τ_h はそれぞれダイヤモンド中での電子、ホールの寿命を表す。また、E がある 大きさを超えると、 $\mu_e E$ 、 $\mu_h E$ は飽和速度 $\mu_e E = v_e$ 、 $\mu_h E = v_h$ で一定になる。電荷収集 間隔 $\bar{d}[\mu\mathbf{m}]$ は、

$$d \equiv d_e + d_h \tag{4.2}$$

$$= (\mu_e \tau_e + \mu_h \tau_h) E \tag{4.3}$$

となる。ダイヤモンド中で生成された電子とホールは、バイアス電圧によって電極に移動 するとき、不純物によるエネルギー準位などに一部が捕獲される。厚さ D のダイヤモンド において、 $\bar{Q}_{mip-generated}$ を生成された電荷量の平均値、 $\bar{Q}_{collected}$ を電極まで到達した電荷 量の平均値とすると、

$$d \approx \frac{Q_{\text{collected}}}{\bar{Q}_{\text{mip-generated}}/D}$$

$$= \frac{\bar{Q}_{\text{collected}}}{36[e^{-}/\mu\text{m}]}$$

$$(4.4)$$

となる。科学の進歩のより、CVDダイヤモンドについては、電荷収集間隔が約250 µmの ウェハーまで製造することが可能となっている。 Pumping 効果

CVDダイヤモンドは多結晶構造のため、主に結晶粒の境界が不純中心となりシグナルの減 少を招く。この現象は pumping 効果として知られている。Pumping 効果は、それらエネ ルギー準位がキャリアによって埋め尽くされる(pumped 状態)まで続く。ここである特 定の波長の光を照射するか熱すると元の状態(depumped 状態)に戻る(depumping)が、 そうでなければ pumped 状態は長く(数ケ月)続くことが知られている。

図 4.6 に pumping、depumping 効果の概念図を示す。CVDダイヤモンドの不純中心は、 主に2つのエネルギーバンドからなるとされている。1つは1.7< E <2.7 にある A バンド、 もう1つは1.2< E <1.7 にある B バンドで、双方ともエネルギーギャップの中心より下の エネルギーに位置する。Pumped 状態では両バンドとも中性で、一方 depumped 状態では、 A バンドは正に帯電しており、B バンドは負に帯電している。

Depumped 状態において、エネルギー E > 5.5 eVの光子により価電子帯から電離された 電子は A バンドに捕獲され正電荷を中性化する(図 4.6(a))。一方、価電子帯のホールは B バンドに捕獲され負電荷を中性化する(同図 (b))。また、E > 3.7 eVの光子により B バン ドの電子は伝導帯に励起され、A バンドの正電荷を中性化し得る(同図 (c))。A バンドの 正電荷も同様に B バンドの負電荷を中性化する(同図 (d))。

Pumped 状態においては、E > 2.7 eVの光子はAバンドから電子を電離してAバンド を正に帯電させ、さらに伝導帯に励起された電子はBバンドに捕獲されBバンドを負に帯 電させる(同図 (e))。また、同様にE > 1.7 eVの光子によりBバンドは負電荷に、Aバン ドは正電荷に帯電し得る(同図 (f))。

すなわち、CVDダイヤモンドは入射光子のエネルギーによって pumping されるか depumping されるかが決まる。 $E = 1.2 \sim 1.7 \text{ eV}$ 、 $2.7 \sim 3.7 \text{ eV}$ の光子は depumping に寄与し、 $E = 1.7 \sim 2.7 \text{ eV}$ および E > 3.7 eVの光子は pumping に寄与する。

Pumping 効果を定量的に評価するため、簡単なモデルを考える。単一の深い不純中心 (エネルギーギャップの中心付近にある不純中心)を仮定する。そして、サンプルへの照射 は一様であるとし、キャリア捕獲の確率は捕獲していない不純中心濃度と放射線量に比例 するとしたとき、電荷収集間隔 *d* は放射線量 Φ の関数として次式で表される。

$$\bar{d}(\Phi) = \frac{\bar{d}(\infty)}{1 + \alpha \exp(-\Phi/\tau)} \tag{4.6}$$

ここで、 α は捕獲可能な不純中心と捕獲できない不純中心の比で、 τ は時定数である。こ れより、放射線量が小さい場合には pumping 効果はより顕著に現れることが分かる。37 MBq の ⁹⁰Sr β 線源を用いた測定では、 τ =64 min という結果が報告されている。また、電 荷収集間隔の収束値 $\bar{d}(\infty)$ は印加バイアスに依存することが知られている。



図 4.6: Pumping、depumping 効果。

本章では、T2K ミューオンモニターで用いる CVD ダイヤモンド 検出器について、第 3.1.1 小節で見積もった 1.3×10^8 particles/cm²/spill のビームに対する応答を評価するため に行ったビームテストの概要と評価結果を述べる。

CVDダイヤモンド検出器に対するビームテストは、1週間ずつのビームタイムで、2005 年10月、2006年7月、そして2007年6月に、京都大学化学研究所先端ビームナノ科学セ ンターにある100 MeV 電子線形加速器(LINAC)を用いて行った。図5.1にLINACの概 観を示す。図上部の電子蓄積リングは用いず、LINACからの電子ビームを直接照射した。 以下、2005年10月、2006年7月のビームテストをそれぞれ、ビームテスト1、ビームテ スト2と呼ぶ。



図 5.1: 100 MeV 電子線形加速器の概観。電子ビームを発生させる熱電子銃、ビームを進行方向に圧縮するバンチャー、高周波電界によって 100 MeV まで電子を加速する 3 本の加速管から構成される。

5.1 ビームテスト 1、2

まずは、ビームテスト1と2について説明する。

CVDダイヤモンド検出器について、まずビームテスト1で大強度のビームに対してどの ような応答を示すか確認し、次にビームテスト2で動作特性について研究した。 測定項目を以下に挙げる。

- シグナルの波形
- •印加電圧依存性(バイアススキャン)
- 応答の個体差
- リニアリティー
- Warm-up 時間
- 時間安定性

5.1.1 ビームテストのビームパラメータ

ビームテストのビームパラメータについて述べる。

ここで、T2K デザイン値(MR: 40 GeV, 0.60 MW)のビーム強度を j_{T2K}^{max} と定義する。 j_{T2K}^{max} のときのミューオンモニターにおけるビーム強度は、第 3.1.1 小節のシミュレーショ ンから、最大で ~1.3×10⁸ particles/cm²/spill と見積もられた。ミューオンモニターでは バンチごとの測定を行うので、1 スピルおよび単位面積当たりのビーム強度を、1 バンチお よび検出器の有感領域当たりの入射ビーム強度に換算すると、CVDダイヤモンド検出器で は ~1.5×10⁷ particle/(0.95 cm)²/bunch となる。

第3.1.1 小節のシミュレーションによると、ミューオンモニターにくる荷電粒子の84% は ミューオンである。ミューオンの平均エネルギーは2.9 GeV であり、ダイヤモンドについ て2.9 GeV ミューオンのエネルギー損失と100 MeV 電子のエネルギー損失は、ほぼ MIP のエネルギー損失に等しく~2 MeV cm²/g である。さらに電離エネルギーは入射粒子の 種類とエネルギーにほとんど依存しない。したがって、T2K ビームにおける1粒子当たり の電荷生成数と、LINAC ビームによる1電子当たりの電荷生成数はほぼ同じと考えられ る。ビームテストでは、CVD ダイヤモンド検出器に対してビーム中心 0.95×0.95 cm² の 部分を有感領域に入射するので、J^{max} 強度のビームは 1.5×10⁷ e/(0.95 cm)²/pulse に対応 する。よって検出器の測定の際には、この入射ビーム強度を狙ってビームを調節した。な お、ビーム強度は熱電子銃のフィラメントに印加する電圧を変えることで調整できる。 表5.1 に各ビームテストで用いたビームパラメータをまとめた。

44

		ビームテスト 1	ビームテスト 2
電子エネルギー [MeV]		100	100
ビーム強度 [e/pulse]	(Si, Dia)	$(1.6{\sim}7.6){\times}10^8$	$3{\times}10^5{\sim}2{\times}10^8$
ビーム半径 σ [cm]		~ 1.0	~ 0.79
有感領域への入射ビームの割合 [%]	(Dia)	8.54	17.7
パルス幅 [nsec]		~ 40	~ 50
パルス振動数 [Hz]		$\sim \! 15$	$\sim \! 15$

表 5.1: 測定で用いた LINAC のビームパラメータ。

5.1.2 ビームテスト1(2005年10月)のセットアップ

セットアップの概観を図 5.2 に示す。図(上)のように、ビームパイプの先(図 5.1 の分 析電磁石のすぐ後ろ)から約 1.5 m 下流の位置に、3 つの CVD ダイヤモンド検出器サンプ ル(Dia1, 2, 3)および、レファレンスとしてのシリコン PIN フォトダイオードサンプル (Si1)をビーム軸に一直線に並べこれらを同時に測定した。ここで、物質によるビームの 散乱はなく、各検出器に入射する単位面積当たりの粒子数は同じと仮定する。この検出器 一式は 2 軸型移動ステージで固定した。ビームプロファイルを測定するときはその検出器 一式を移動ステージから外し、代わりにプロファイルモニターを取り付けて測定した(同 図(下))。なお、プロファイルモニターは、Si3 がビーム中心にくるように配置した。

図 5.3 に測定の回路図を示す。測定機器は実験室内に置き、検出器のシグナルを直ちに読み出した。各シグナルはアッテネータで-38~-52 dB に減衰し、測定レンジ 1 nC のチャージ積分型 ADC で測定した。DAQ 制御、バイアス設定、ゲートの調整、オシロスコープの 波形取り込みはコントロール室で行った。トリガーには加速器電子銃からの TTL 信号を用いた。

5.1.3 ビームテスト 2(2006年7月)のセットアップ

セットアップの概観を図 5.4 に示す。ビームパイプの先端直後に CT1、そこから約 1m 下流に CT2 を配置し、ビーム強度を測定した。4 つの CVD ダイヤモンド検出器サンプル (Dia1, 2, 3, 4) および、2 つのシリコン PIN フォトダイオードサンプル(Si2, 3) をビー ム軸に一直線に並べ、これらを CT2 の後ろに配置し同時に測定した。CVD ダイヤモンド 検出器の両側をシリコン PIN フォトダイオードで挟むことで、検出器によるビーム散乱の 効果を検証する。最下流には 9 つのシリコン PIN フォトダイオードで構成するプロファイ ルモニターを置いてビームプロファイルを測定した。なお、プロファイルモニターは、中 心のチャンネルがビーム軸上にくるように配置した。



図 5.2: ビームテスト 1、CVDダイヤモンド検出器測定のセットアップ図。シリコン PIN フォトダイオードはプリント基板、CVDダイヤモンド検出器は薄いアクリル板に固定して ある。



図 5.3: ビームテスト 1、CVD ダイヤモンド 検出器測定の回路図。上側が LINAC のある ビームライン室で、下側が LINAC を制御するコントロール室。

図 5.5 に測定の回路図を示す。基本的にビームテスト 1 と同じである。CVD ダイヤモン ド検出器とシリコン PIN フォトダイオードのシグナルはアッテネータで-10~-54 dB に減 衰し、測定レンジ 1 nC のチャージ積分型 ADC で測定した。また、CT1、2 のシグナルは PMT アンプで 10 倍に増幅し、同じく ADC で測定した。



図 5.4: ビームテスト 2、CVDダイヤモンド検出器測定のセットアップ図。



図 5.5: ビームテスト 2、CVDダイヤモンド検出器測定の回路図。

5.1.4 CVDダイヤモンド検出器の性能評価

 j_{T2K}^{max} 強度のビーム(ミューオンモニターにおいて、 $\sim 1.6 \times 10^7$ particles/cm²/bunch)に 対する CVD ダイヤモンド検出器の性能を評価する。4 つのサンプル(Dia1, 2, 3, 4)につ いて以下の項目を測定した。

- シグナルの波形
 オシロスコープでシグナルの波形を測定し、応答が十分速く、バンチごとの測定が可
 能かどうか評価する。
- 印加電圧依存性(バイアススキャン)
 印加電圧(バイアス)に対する応答を測定し、動作電圧を決定する。
- 応答の個体差

ー般に CVD ダイヤモンド検出器は、そのウェハーの製造工程および結晶構造のため、 応答に個体差が現れる。バイアススキャンの結果から 4 つのサンプルの個体差を評価 する。

- リニアリティー
 T2K ミューオンモニターにくる大強度ビームに対する応答のリニアリティーを評価
 する。
- Warm-up 時間
 Pumping 効果を検証し、Warm-up に必要な時間を測定する。
- 時間安定性

1時間の連続動作で、応答の安定性を評価する。

シグナルの波形

ビームテスト1において、オシロスコープで測定した CVD ダイヤモンド検出器の波形を 図 5.6 に示す。図はバイアスを変えていったときの応答の変化を測定したものである。入射 ビーム強度は ~ $5.0 \times 10^7 \text{ e/cm}^2$ /pulse($\jmath_{\text{T2K}}^{max}313\%$)である。バイアスを上げるにつれ、電 荷収集間隔が広がり、徐々にパルスが高くなっていく様子が分かる。

CVDダイヤモンド検出器のパルス幅は約 50 nsec で、T2K ビームのバンチ間隔 (~700 nsec)より十分速いので、バンチごとの測定が可能である。

ここで、ダイヤモンド中のキャリアのドリフト速度について考察する。今、厚さ 500 µm のウェハーにバイアス 500 V を印加している。このときすでに飽和電場に達しているので、

キャリアは飽和速度で移動する。ダイヤモンド中の電子の飽和速度は 2×10⁷ cm/sec、ホールの飽和速度は 10⁷ cm/sec である。したがって、キャリアの平均収集時間は 1.7 nsec となる。よって、CVDダイヤモンド検出器のシグナルの波形は、ほぼ入射ビームの形を示すと予測される。本測定におけるビームのパルス幅は約 40 nsec であり、これは測定の結果とよく一致している。

バイアススキャン

ここでは、ビームテスト 2 の測定結果について述べる。バイアスを 0 V から 600 V ま で 8 点スキャンし、各バイアスでの CVD ダイヤモンド検出器の応答を測定した。検出器 の応答が安定するまでの時間を空けるため、測定はバイアスを変更してから 1 分間待って 行った。ビームテスト 1 での warm-up 時間の測定(第 5.1.4 小節)から、バイアス印加 1 分後以降のシグナルの変動は 1% 以内であった。測定の結果を図 5.7(緑三角点)に示す。 縦軸に Si1 との収集電荷の比をとった。このとき、入射ビーム強度は ~7×10⁶ e/cm²/pulse ($j_{T2K}^{max}44\%$)である。また、入射ビーム強度~8×10⁷ e/cm²/pulse($j_{T2K}^{max}500\%$)において も同様の測定を行い、同じ図上にプロットした(青四角点)。

第5.1.4 小節で議論したとおり、バイアス 500 V はすでに飽和電圧を越えており、これ 以上バイアスを上げてもシグナルの増加は見込めない。本測定においても、バイアス 500 Vを超えてもシグナルはまだ徐々に増加しているものの、600 V における応答のバイアス 依存性は 0.1% /V 以下で十分小さい。次節で詳しく述べるが、低バイアスでの応答は入射 ビーム強度が高くなると飽和してくるので、できるだけ高いバイアスで動作することが必 要である。よって、動作電圧はもっとも電荷収集効率の良い最大印加許容電圧の 500 V に 設定した。

バイアス 500 V における Dia1、2、3、4 の収集電荷は、入射ビーム強度~7×10⁶ e/cm²/pulse においてそれぞれ、シリコン PIN フォトダイオードの収集電荷(32.9 nC)の 25.9%、31.7%、 29.2%、30.1% であった。式 (4.5) より、これらサンプルの電荷収集間隔はバイアス 500 V においてそれぞれ、231 μ m、287 μ m、261 μ m、269 μ m である。入射ビーム強度~8×10⁷ e/cm²/pulse においては、収集電荷比は 21.8%、29.5%、23.4%、24.2%、電荷収集間隔は 138 μ m、186 μ m、148 μ m、153 μ m であった。入射ビーム強度によって電荷収集間隔が 異なるのは、CVDダイヤモンド検出器の応答がこれらのビーム強度に対してはリニアーで ないことを示している。

表 5.2 に電荷収集間隔の値をまとめる。



図 5.6: オシロスコープで測定した CVDダイヤモンド検出器の波形。上から、ゲート、Dia1、 Dia2 の波形である。Dia1、2 にかけるバイアスを変えて測定した。左上:100 V、右上: 200 V、左中:300 V、右中:400 V、左下:600 V。シグナルは-52 dB に減衰してある。



図 5.7: CVD ダイヤモンド検出器のバイアス依存性。縦軸に Si2 との収集電荷比をとった。緑三角点は \sim 7×10⁶ e/cm²/pulse、青四角点は \sim 8×10⁷ e/cm²/pulse で測定した結果 を示す。

入射ビーム強度 [e/cm ² /pulse]	${\sim}7{\times}10^6$	${\sim}8{\times}10^7$
Dia1	231	138
Dia2	287	186
Dia3	261	148
Dia4	269	153

表 5.2: CVD ダイヤモンド 検出器の電荷収集間隔 [μm]。

応答の個体差

前節の測定から分かるように、4 つのサンプル間の応答には個体差があり、バイアス 500 Vにおいて最大約 30% になった。検出器の並び順によって物質によるビーム散乱が影響し、 入射粒子数が各サンプルで異なるが、シグナルの大きさの順番は並び順とは異なるので、 この個体差の原因として入射粒子数の違いという可能性は否定される。他に考えられる原 因としては、バイアスを印加する電極の違いが挙げられる。CVDダイヤモンド検出器の電 極に極性はないが、ウェハーには成長面と核形成面がありそれぞれ結晶の大きさが異なる ので、どの向きにバイアスをかけるかで応答に違いが現れる可能性がある。この可能性を 検証するため、ビームテスト 2 で以下の測定を行った。

まずバイアスをかける電極を任意に選んで測定し、次に逆側の電極からバイアスをかけて 同様の測定を行い、両者の違いを検証した。図 5.8 の赤丸点が前者の、青四角点が後者の測 定結果である。また、両者の差を図 5.9 に示す。なお、この測定でのビーム強度は、前者のと きが ~ $6\times10^7 \text{ e/cm}^2/\text{pulse}(\ \jmath_{\text{T2K}}^{max}375\%)$ 、後者のときが ~ $8\times10^7 \text{ e/cm}^2/\text{pulse}(\ \jmath_{\text{T2K}}^{max}500\%)$ である。

バイアス電極による応答の系統的な違いは見られなかった。しかし、本測定の入射ビー ム強度は~6,8×10⁷ e/cm²/pulseで、次節で述べるリニアリティー測定の結果から、この 入射ビーム強度では CVDダイヤモンド検出器とシリコン PIN フォトダイオードの応答は 飽和してきていることを考慮しなくてはならない。特にシリコン PIN フォトダイオードの 飽和の方が著しいため、入射ビーム強度が高くなるにつれ Dia/Si の比は大きくなる。すな わち本測定においては、後の測定(図5.8の青四角点)の方が前の測定(同図赤丸点)よ りも Dia/Si の比は大きくなるはずである。しかし、Dia1 の低バイアス側および Dia4 の 測定点は、それとは逆になっている。また、Dia3 には両測定間にその比の変化は見られな い。つまり、Dia/Si の比が予想よりも小さくなっているのは、バイアスをかける向きを変 えたことに起因する可能性がある。これについては、CVDダイヤモンド検出器、シリコン PIN フォトダイオードとも線形な応答を示す入射ビーム強度で再度測定して確かめる必要 がある。

以上の結果から、4つのサンプルの応答の個体差は、単純に各サンプルのウェハーに起因 するものとも考えられる。CVDダイヤモンドウェハーの製造工程上、別々に作られたウェ ハーの性能はばらついてしまう。この4つのサンプルのウェハーは同一のウェハーから切 り取ったものであるが、それでも応答に個体差が生じるのは、同じ1枚のウェハーでも図 4.3のように結晶粒の構造は一様ではなく、切り取る場所によってその性能に違いが現れる ためと考えられる。したがって、実機で使用する場合は検出器1つひとつについて測定し、 あらかじめ個体差を評価しておく必要がある。



図 5.8: CVDダイヤモンド検出器のバイアス依存性。縦軸に Si2 との収集電荷比をとった。 赤丸点は最初の測定、青四角点はバイアスをかける電極を変えて測定した結果を示す。



図 5.9: バイアス電極を変えたときの応答の変化の割合。

リニアリティーの評価

ここでは、ビームテスト 2 の測定結果について述べる。バイアス 100 V と 500 V におい て、入射ビーム強度 $3 \times 10^5 \sim 5 \times 10^6$ e/cm²/pulse($j_{T2K}^{max} 1.9 \sim 31\%$)に対する CVDダイヤモ ンド検出器の応答を測定した。図 5.10 にバイアス 100 V、図 5.11 にバイアス 500 V のと きの結果を示す。横軸に Si2 の収集電荷、縦軸に CVD ダイヤモンド検出器の収集電荷を とった。Si2 の収集電荷 6.8 nC が $j_{T2K}^{max} 10\%$ に対応する。また、バイアス 500 V において、 入射ビーム強度 6.6×10⁶~2.2×10⁸ e/cm²/pulse($j_{T2K}^{max} 41 \sim 1400\%$)に対する応答も測定し た。このビーム強度ではシリコン PIN フォトダイオードの応答が飽和して線形でないので、 レファレンスには CT1 を用いる。その結果を図 5.12 および図 5.13 に示す。CT1 の収集電 荷 0.004 nC が j_{T2K}^{max} に対応する。

バイアス 100 Vでは、低いビーム強度に対しても応答が飽和してきている。 - 方、バイ アス 500 Vでは、Si2 の収集電荷 1~22 nC に対して、どのサンプルも+1.5, -2.0% 以内の 線形な応答を示した。しかし、図 5.11(右)を見ると、入射ビーム強度が高くなるにつれ て徐々に応答が飽和してきていることがわかる。実際、図 5.12 で CT1 の収集電荷が 0.005 nCを越えたあたりから、応答の飽和が顕著に現れている。なお、Dia2 のグラフで CT1 の 収集電荷 0.04 nC 以降は ADC がオーバーフローしている。図 5.13(右)より、入射ビー ム強度 $6.6 \times 10^6 \sim 2.0 \times 10^7 \text{ e/cm}^2/\text{pulse}(j_{\text{T2K}}^{max}41 \sim 125\%)$ におけるフィット直線からのずれ は、Dia1, 2, 3, 4 についてそれぞれ、+1.3, -1.0%、+1.3, -1.0%、+1.8, -1.7%、±1.7% で あった。なお、CT1 の出力電荷 0.002 nC の点のフィット直線からのずれが大きいのは、シ

5.1. ビームテスト 1、2

リコン PIN フォトダイオードもその点で同じような振る舞いをしていたので、検出器の応答ではなくビームによるものと考えられる。

入射ビーム強度 $3 \times 10^{5} \sim 2.4 \times 10^{7}$ e/cm²/pulse ($j_{T2K}^{max} 1.9 \sim 150\%$)の範囲で図 5.11 と図 5.12 の結果をまとめると図 5.14 のようになる。横軸に Si2、CT1 から求めた入射ビーム強 度をとった。Si2をレファレンスにしたときの測定点を緑で、CT1をレファレンスにした ときの測定点を青で示した。図(左)より、入射ビーム強度 $3 \times 10^{5} \sim 1.6 \times 10^{7}$ e/cm²/pulse ($j_{T2K}^{max} 1.9 \sim 100\%$)におけるフィット直線からのずれは、Dia1、2、3、4 についてそれぞれ、+1.5、-12.5%、+8.7、-1.9%、+2.0、-10.6%、+2.1、-10.0% で、電荷収集間隔(表 5.2)の大 きいサンプルほどリニアリティーがよいという結果を得た。

Warm-up 時間

CVDダイヤモンド検出器の warm-up の特性を調べるため、ビームテスト1において以下の手順により測定を行った。

バイアススキャンを終えた後バイアスを切って、ビームを照射しない状態で 10 分待ち、 それから Dia1, 2, 3 の順にバイアスを 500 Vまでかけた。なお、1ch バイアスをかけるのに 1 分弱要している。そして Dia3 のバイアスをかけ終わると同時に、ビーム照射とデータの 読み出しを開始した。その時間を 0 とする。そのまま約 11 分間、CVDダイヤモンド検出 器の応答を測定した。得られた応答の時間分布を図 5.15 に示す。縦軸に Si1 との収集電荷 の比をとった。なお、この測定での入射ビーム強度は $\sim 5 \times 10^7 \text{ e/cm}^2/\text{pulse}(j_{\text{T2K}}^{\text{max}} 313\%)$ である。

Dia1 は測定の 11 分間、 $\pm 0.5\%$ 以内の変動でずっと安定に動作している。Dia2 の応答は ビーム照射開始時から徐々に減衰しているが、時間 0 sec と 650 sec の間の下がり幅は 1.4% 程度である。一方、Dia3 は pumping 効果と思われる応答を示している。ビーム照射開始 時から徐々に立ち上がり、100 sec 以降は $\pm 0.2\%$ 以内の変動で安定する。Dia3 の電荷収集 間隔の時間分布を式 (4.6) でフィットしたときのパラメータの値を表 5.3 に示す。立ち上が りの時定数 τ は 40.7 sec であった。

$\bar{d}(\infty)$ [µm]	244
α	$3.00{\times}10^{-2}$
$\tau \; [sec]$	40.7

表 5.3: Dia3の pumping パラメータのベストフィット。

ここで、この測定はバイアススキャンの10分後に行ったということに注意したい。すなわち、一度 pumping されるとその状態は数ケ月のオーダーで続くことから、Dia3 はすで



図 5.10: バイアス 100 V。3×10⁵~5×10⁶ e/cm²/pulse における CVD ダイヤモンド検出器 のリニアリティー。(左)横軸に Si2 の収集電荷、縦軸に Dia1, 2, 3, 4 の収集電荷。直線は、 ビーム強度の低い方 31 点でフィットしたもの。 (右)測定点のフィットからのずれ。



図 5.11: バイアス 500 V。 $3 \times 10^5 \sim 5 \times 10^6 \text{ e/cm}^2/\text{pulse}$ における CVD ダイヤモンド検出器 のリニアリティー。(左)横軸に Si2 の収集電荷、縦軸に Dia1, 2, 3, 4 の収集電荷。直線は、ビーム強度の低い方 91 点でフィットしたもの。 (右)測定点のフィットからのずれ。



図 5.12: $6 \times 10^6 \sim 2 \times 10^8$ e/cm²/pulse における CVDダイヤモンド検出器のリニアリティー。 (左)横軸に CT1 の出力電荷、縦軸に Dia1, 2, 3, 4 の収集電荷。直線は、ビーム強度の低 い方 5 点でフィットしたもの。Dia2 の横軸 0.04 nC 以降は ADC のオーバーフローによる ものである。 (右)測定点のフィットからのずれ。



図 5.13: 6×10⁶~2×10⁷ e/cm²/pulse における CVDダイヤモンド検出器のリニアリティー。 (左)横軸に CT1 の出力電荷、縦軸に Dia1, 2, 3, 4 の収集電荷。 (右)測定点のフィッ トからのずれ。CT1 の出力電荷 0.002 nC の点のずれはビームによるものである。



図 5.14: $3 \times 10^5 \sim 2.4 \times 10^7$ e/cm²/pulse における CVD ダイヤモンド 検出器のリニアリティー。(左) 横軸に Si2 および CT1 から求めた入射ビーム強度($\times 10^6$ e/cm²/pulse) 縦軸 に Dia1, 2, 3, 4 の収集電荷。緑点が Si2、青点が CT1 をレファレンスにしたときの測定点 を示す。赤線は、緑点をフィットしたもの。 (右)測定点のフィットからのずれ。



図 5.15: CVD ダイヤモンド検出器の応答の時間分布。

に pumped 状態にあるはずである。しかし、このように応答の立ち上がりが遅いのは、数 eVの光子が入射するなどして depumping が起こったか、あるいは pumping 効果以外の機 構が働いているものと思われる。Depumping については、CVDダイヤモンド検出器は銅 テープシールドで覆われているので、数 eVの光子がウェハーに入射することは考えにく い。本測定では Dial、2 には応答の立ち上がりが見られなかったが、Dia3 と違い Dial、2 にはビーム照射開始(測定開始)の1~2分前にバイアスを印加していることを考えると、 バイアスの印加時間が立ち上がりに影響している可能性もあると考えられる。

この可能性を検証するため、ビームテスト2において、次の2通りの方法で CVD ダイ ヤモンド検出器の応答を測定した。

1. バイアスをかけて約1分後にビームを照射し始める。

2. ビームを照射し始めて約1分後にバイアスをかける。

なお、この測定での入射ビーム強度は $\sim 9 \times 10^6 \text{ e/cm}^2/\text{pulse}$ ($j_{\text{T2K}}^{max} 55\%$) である。

1., 2. の測定結果を同じ図上にプロットした。図 5.16 がその結果である。ビーム照射開 始時間またはバイアス印加開始時間を 0 min とし、1. の測定を青線で、2. の測定を赤線で

示した。赤線の方が立ち上がりが遅いのは、バイアスを設定値の 500 V までかけるのに約 0.2 min 要したためである。ビーム自身の立ち上がり時間は 1 秒程度である。

Dia1, 2 と Dia3,4 で異なる応答を示すことが分かった。Dia1, 2 の応答が安定点まで達 するのに要する warm-up 時間は Dia3, 4 よりも速く、5 秒程度である。一方、Dia3, 4 の warm-up 時間は約3分である。この結果は前述のビームテスト1の結果と一致する。なお、 時間0で青線がオーバーシュートしているのは、ビームの出始めで Si2 のシグナルが非常 に小さいためである。

測定方法 1., 2. による応答の違いは見られなかった。これは、ある程度の量のキャリア がダイヤモンドのウェハー内をドリフトしない間は、キャリアが何らかの理由で失われて しまうということを示している。これは、伝導帯あるいは価電子帯の近傍に浅い不準中心 があって、 - 般的な pumping 効果よりもごく短い時定数で pumping 効果が起こっている ためと考えられる。

さらに、ビームテスト 2 において、バイアスをかけた状態でビーム照射オン-オフを繰り 返す測定を行った。バイアスを 500 V かけ、ビームオフの状態で測定を開始し、約 2 分後 にビーム照射を開始し、その後約 5 分間隔でビーム照射オフ-オンを 3 度繰り返した。その 結果を図 5.17 に示す。このときの入射ビーム強度は $\sim 8 \times 10^7 \text{ e/cm}^2/\text{pulse}(\jmath_{\text{T2K}}^{max} 490\%)$ で ある。

ここでも Dia1, 2 と Dia3, 4 で異なる応答を示すことがわかった。Dia1, 2 の応答の warmup 時間は、最初のビーム照射時は 5 秒程度で、2 回目以降も変わらず 5 秒程度であった。 -方、Dia3, 4 の warm-up 時間は、最初のビーム照射時は約 3 分で、2 回目以降は約 20 秒で あった。

この測定により、ビーム照射間隔が5分空くとCVDダイヤモンド検出器の応答の立ち 上がりを考慮しなければならないことが分かった。しかし、LINACのビーム繰り返し15 Hzでは - 度応答が立ち上がれば安定に動作するので、ビーム照射間隔60 msec以下、すな わちT2Kビームのバンチ間(~700 nsec)の応答の立ち上がりは考慮しなくてよい。しか し、スピル間隔(~3.5 sec)の応答の立ち上がりについては今後確認が必要である。

時間安定性

ビームテスト 2 において、強度 $\sim 1 \times 10^7 \text{ e/cm}^2/\text{pulse}$ ($\jmath_{\text{T2K}}^{max}62\%$)のビームを約1時間照 射し、CVDダイヤモンド検出器の応答の時間安定性を測定した。バイアスを切ってビーム を照射している状態でデータを取り始め、その時間を0とした。バイアスはその後 Dia1、 2、3、4 の順に 500 V まで印加した。図 5.18 にその結果を示す。図左に Si3 との収集電荷 の比、図右に各測定点の平均値(測定開始から 10 分後以降のデータの平均)からのずれ



図 5.16: CVD ダイヤモンド検出器の warm-up 時間。バイアスをかけた状態でビームを照 射し始めたときの応答が青線、ビームを照射した状態でバイアスをかけ始めたときの応答 が赤線である。

63



図 5.17: CVDダイヤモンド検出器の warm-up 時間。ビームのオン-オフを約5分間隔で繰 り返した。

5.1. ビームテスト 1、2

をプロットした。図中プロットが途切れているのは、ADCのオーバーフローによるもので ある。

初めの warm-up 時間を除けば、バイアス印加後 10 分以降はどのサンプルも ±2% 以内 の変動で安定に動作していることが分かった。時間 45 min の点など途中シグナルが急激に 変化しているのは、どのサンプルも同じような挙動を示しているので、検出器の性能では なくビーム由来のものと考えられる。

5.1.5 測定結果のまとめ

LINAC の電子ビームを用いて、 \mathcal{J}_{T2K}^{max} 強度(ミューオンモニターにおいて $\sim 1.6 \times 10^7$ particles/cm²/bunch)のビームに対する CVD ダイヤモンド 検出器の応答を測定し、以下の結果を得た。

- シグナルの波形 強度 ~5×10⁷ e/cm²/pulse(*J*^{max}_{T2K}313%)、パルス幅約 40 nsec にビームに対して、パルス幅約 50 nsec の応答を示す。すなわち、T2K ミューオンモニターにおいて、バン チごとの測定が可能である。
- 印加電圧依存性(バイアススキャン)

バイアス 500 Vを越えてもなおシグナルは増加し続けるが、バイアス依存性は 500 Vにおいて 0.1% /V以下である。リニアリティーを良くするため、動作電圧は最大許容電圧の 500 Vに設定する。Dia1、2、3、4 の電荷収集間隔は、入射ビーム強度 ~7×10⁶ e/cm²/pulse($j_{\text{T2K}}^{max}44\%$)、バイアス 500 Vにおいてそれぞれ、231 μ m、287 μ m、261 μ m、269 μ m である。入射ビーム強度 ~8×10⁷ e/cm²/pulse($j_{\text{T2K}}^{max}500\%$)に対しては、138 μ m、186 μ m、148 μ m、153 μ m である。

応答の個体差

CVD ダイヤモンド検出器は応答に個体差がある。4 つのサンプルについて、バイアス 500 V における個体差は最大で約 30% ある。

• リニアリティー

バイアス 100 V では 500 V に比べ早く飽和し始める。バイアス 500 V では、強度 $3\times10^5\sim1.6\times10^7$ e/cm²/pulse ($\jmath_{T2K}^{max}1.9\sim100\%$)のビームに対して、Dia1 は+1.5, - 12.5%、Dia2 は+8.7, -1.9%、Dia3 は+2.0, -10.6%、Dia4 は+2.1, -10.0% のリニア リティーがある。電荷収集間隔の大きいものほどリニアリティーも良い。また、強度 $6.6\times10^6\sim2.0\times10^7$ e/cm²/pulse ($\jmath_{T2K}^{max}41\sim125\%$)のビームに対するリニアリティー



図 5.18: CVD ダイヤモンド検出器の応答の時間安定性。

は、Dia1は+1.3, -1.0%、Dia2は+1.3, -1.0%、Dia3は+1.8, -1.7%、Dia4は±1.7% である。

- Warm-up 時間 最初のビーム照射時の応答の warm-up 時間は、Dia1,2は約5秒、Dia3,4は約3分 である。また、ビーム照射間隔が5分のときの warm-up 時間は、Dia1,2は約5秒、 Dia3,4は約20秒である。
- 時間安定性

応答が安定点まで立ち上がってから約1時間、どのサンプルも±2%以内の変動で安定に動作する。

シグナルの大きさについて、本測定においてはバイアスの向きによる系統的な違いは見られなかったが、検出器の応答が線形な領域のビーム強度で再度測定し直す必要がある。 warm-up時の応答としては、Dia3,4に比較的時定数の短いpumping効果が現れたが、な ぜDia3,4にだけ現れているのかは分かっていない。また、T2Kビームのスピル間隔(~3.5 sec)での応答のwarm-up時間を今後評価する必要がある。

5.2 ビームテスト(2007年6月)

次に、2007 年 6 月 11 日 ~15 日に行ったビームテストについて説明する。 ここでは、CVD ダイヤモンド検出器サンプルの応答の個体差についての考察を述べる。

5.2.1 セットアップとビームパラメータ

今回のビームテストで用いたビームパラメータを表 5.4 にまとめた。

電子エネルギー [MeV]	100
ビーム強度 [e/pulse]	$10^6 \sim 10^9$
	$j_{\mathrm{T2K}}^{max} = 1.6 \times 10^8 \text{ e/cm}^2/\text{pulse}$
ビーム半径 σ [cm]	~ 0.6
パルス幅 [nsec]	~ 50
	15

表 5.4: 測定で用いた LINAC のビームパラメータ

セットアップの概観を図 5.19 に示す。ビームパイプの先端から約 8 cm のところに CT1、 そこから約 63.5 cm 下流に CT2、またそこから約 5.5 cm 下流に CT3 を配置し、ビーム強

度を測定した。その下流約 12.3 cm のところに、9 つのシリコン PIN フォトダイオードで 構成するプロファイルモニターを置いてビームプロファイルを測定した。そしてその約 7 cm のところに 5 つの CVD ダイヤモンド検出器サンプル(Dia1, 2, 3, 4, 5) および、2 つ のシリコン PIN フォトダイオードサンプル(Si1, 2) をビーム軸に一直線に並べ、同時に 測定した。なお、プロファイルモニターは、中心のチャンネルがビーム軸上にくるように 配置した。

図 5.20、図 5.21 に測定の回路図を示す。







図 5.20: CVD ダイヤモンド検出器測定の回路図。LINAC のあるビームライン室。
5.2. ビームテスト(2007年6月)



図 5.21: CVD ダイヤモンド検出器測定の回路図。コントロール室。

5.2.2 シグナルの波形

オシロスコープで測定した CVD ダイヤモンド 検出器の波形を図 5.22 に示す。図(上) はバイアス 300 V、図(下)はバイアス 500 V を印加したときの波形である。

CVDダイヤモンド検出器のパルス幅は約60 nsec で、T2Kビームのバンチ間隔(~700nsec) より十分速いので、バンチごとの測定が可能である。

5.2.3 応答の個体差

応答の個体差が見られるかどうかを検証するため、それぞれの CVD ダイヤモンド検出 器サンプルのシグナルを見た。そのバイアスごとの比較を、図 5.23~図 5.25 に示す。

これらの図から、Dia2に比べ、Dia1,3,4が違う挙動を示していることが分かる。

この結果から、Dia2を基準にとって、Dia1, 3, 4のシグナルの違いをバイアスごとに比較してみた。その比較を、図 5.26~図 5.28 に示す。

これらの図から、Dia1 が Dia3,4 とは違う挙動を示していることが分かる。しかし、バ イアスを上げるにつれ、Dia1,3,4の個体差は小さくなっている。実際 T2K ミューオンモ ニターの CVD ダイヤモンド検出器で印加する予定のバイアス 500 V においては、個体差 は 15~20% になっている。



図 5.22: オシロスコープで測定した CVD ダイヤモンド検出器の波形。上から、ゲート、 Dia1、Dia2、Si1の波形である。Dia1、2 にかけるバイアスを変えて測定した。上: 300 V、 下: 500 V。シグナルは、Dia: -30 dB、Si: -46 dB に減衰してある。



図 5.23: CVDダイヤモンド検出器サンプルのシグナル比較。横軸を Si1[nC]、縦軸を Dia[nC] にとった。(上)バイアス 100 V のとき。 (下)バイアス 200 V のとき。



図 5.24: CVDダイヤモンド検出器サンプルのシグナル比較。横軸を Si1[nC]、縦軸を Dia[nC] にとった。(上)バイアス 300V のとき (下)バイアス 400V のとき



図 5.25: CVDダイヤモンド検出器サンプルのシグナル比較。横軸を Si1[nC]、縦軸を Dia[nC] にとった。バイアス 500 V のとき。

5.2.4 電極面積との関係性

前回までのビームテストにおいて、サンプルの応答の個体差の原因として、各サンプル のウェハーの結晶構造の違いが考えられていた。

ここで、その他の原因を探るため、銅テープとカプトンテープおよびアクリル板で覆われていた CVD ダイヤモンド検出器そのものを見てみたところ、電極に使われている金が 剥離しているものがあることが分かった。

その電極部分の写真を図 5.29 に載せる。図(上)は Dia1 の写真で、表裏を載せている。 左の写真の電極部分で黒くなっているところが、剥がれたあとである。同図(中)は Dia2 の写真で、同じく表裏を載せている。Dia2 の電極はきれいなままであった。同図(下)は 左が Dia3、右が Dia4 の写真である。この 2 つのサンプルの電極は、両面ともきれいなま まであった。

各サンプルの元々の電極面積の大きさについては、Dia1と2、Dia3と4がそれぞれ同程 度の大きさになっていて、Dia1,2の電極面積の方が、Dia3,4のものよりも大きいものと なっていた。

次に、電極の剥離を考慮した電極面積の比較を行った。Dia1の剥がれていた電極の面積 を計算し、他のサンプルとの面積比を、表 5.5 に示す。ここでは、Dia2を基準にとった。



図 5.26: CVDダイヤモンド検出器サンプルのシグナル比較。横軸を Si1[nC]、縦軸を Dia1, 3,4と Dia2 との比にとった。(上)バイアス 100 Vのとき。 (下)バイアス 200 Vの とき。

ダイヤモンドサンプル	1	2	3	4
電極面積比	0.797	1	0.800	0.787

表 5.5: 電極面積の比較。Dia2を基準にとってある。



図 5.27: CVDダイヤモンド検出器サンプルのシグナル比較。横軸を Si1[nC]、縦軸を Dia1, 3,4と Dia2 との比にとった。(上)バイアス 300 Vのとき。 (下)バイアス 400 Vの とき。



図 5.28: CVDダイヤモンド検出器サンプルのシグナル比較。横軸を Si1[nC]、縦軸を Dia1, 3,4と Dia2 との比にとった。バイアス 500 V のとき。

この面積比を基に、各サンプルの収集電荷量の見積り値を計算した。ここで Dial に関し て、実際には片面の電極の剥離しかないが、そこから考えられる電場と収集電荷量との関 係を計算するのは難しいので、両面とも同じように剥がれているものとして考えた。

その見積り値と各サンプルとを比較したものを図 5.30、図 5.31 に示す。

これらの図から、印加するバイアスを上げるにつれて各サンプルの収集電荷量の比が、 電極面積の違いから見積もった収集電荷量の値に近づいていることが分かる。

5.2.5 結果

以上の結果をまとめる。

印加バイアス 500 V において、応答の個体差は約 15~20% となった。

次に、電極部分を見てみたところ、電極がきれいな場合(Dia3,4)と電極が剥がれてい る場合(Dia1)とでは印加するバイアスの変化による挙動の違いも見られた。その原因と しては、Dia1の電極の剥がれ方が複雑であったことから、電極の剥がれ方によるものでは ないかと考えられる。

また、印加バイアスを上げるにつれ、各サンプルの収集電荷量の比が電極面積からの見 積り値に近づいていることから、今まで見られていた応答の個体差はサンプルの電極面積

5.2. ビームテスト(2007年6月)



図 5.29: CVD ダイヤモンド検出器サンプルの電極写真。(上) Dia1。 (中) Dia2。 (下) Dia3, 4。



図 5.30: 面積比から見積もった収集電荷量の比。(上) Dia1 について、(下) Dia3 について。横軸を Si1[nC]、縦軸を Dia2 との比にとった。

5.2. ビームテスト(2007年6月)



図 5.31: 面積比から見積もった収集電荷量の比。Dia4 について。横軸を Si1[nC]、縦軸を Dia2 との比にとった。

によるものだと考えられる。

第6章 ミューオンモニターのデザイン

6.1 検出器の配置とチャンネル数、プロファイル中心の決定精度

第5章の結果から、検出器の測定誤差は、CVDダイヤモンド検出器について ±1.8% 以 内であることが分かった。第3.3.2 小節のシミュレーション結果(図3.9(下))から、この とき図3.9(上)の(A)、(B)、(C)の場合の系統誤差はそれぞれ、 $\sigma(dr)=1.8$ 、1.7、1.4[cm] となっており、どの配置の場合についてもミューオンモニターに対する要請($\sigma(dr)\leq3$ cm) を満たしていることが分かる。よって、これらの配置のうち最もチャンネル数の少ない(A) を採用することにした。チャンネル数は13 チャンネルとなっている。

第7章 結論と今後

T2K 長基線ニュートリノ振動実験のためのミューオンモニターにおける CVD ダイヤモンド検出器についての研究を行った。

まず、T2K 実験においてミューオンモニターに要請される精度を満たすような検出器の 配置やチャンネル数について、シミュレーションの結果からとビームテストの結果を用い て決定した。ミューオンモニターに要請される値は、ミューオン位置プロファイル中心を 3 cm 以上の精度でバンチごとに測定することである。結果、ミューオンモニターの覆うサ イズは 150×150 cm² で、チャンネル数は 13 チャンネルと決定した。

CVDダイヤモンド検出器については、ビーム照射開始時には応答が小さく、それから 徐々に安定点まで立ち上がるという特性があり、さらにその warm-up 時間はサンプルごと に異なっており、今回測定した4つのサンプルの内2つは約5秒、別の2つは約3分であっ た。また、5分の間隔を空けて測定した場合にも warm-up 時間があり、それぞれ約5秒と 約20秒であった。しかし、後の1時間は±2%の変動で安定に動作することが分かった。 また、応答のリニアリティーを良くするため、動作電圧は最大許容電圧の500Vにする。ま た、CVDダイヤモンド検出器の応答は速く(~50 nsec)、パンチビとの測定が可能である (T2Kビームのバンチ間隔(~700 nsec))。応答の個体差については、サンプルごとの結晶 構造の違いによるものと考えられていたが、今回各サンプルの電極面積の違いが見付かり それとシグナルとの関係性について検証したところ、収集電荷量と電極面積が関係してお り、個体差の原因となっている思われる結果となった。

また、今後については、

- •より多くのダイヤモンド検出器サンプルについてのテスト
- T2K 実験におけるミューオンモニター準備と製作
- 2009 年 4 月に T2K 物理ラン開始予定

のようになっている。

付録A 電磁ホーン

ここでは、T2K 実験の標的施設に設置される電磁ホーンについて述べる。

ニュートリノは中性レプトンであり軌道の制御ができないため、その親の π 中間子の軌 道を制御する必要がある。しかし、陽子ビームをグラファイト標的に照射して生成された π 中間子は、ばらばらの方向を向いている。そのため、この π 中間子の向きをそろえるた めに電磁ホーンという装置で収束させる。

図 A.1 に電磁ホーンの概念図を示す。電磁ホーンはアルミニウムの管が二重になった装置で、内側の管から電流を流し、端板を通って外側の管で戻すというものである。この電流によって、内管と外管の間には内管に巻き付くように磁場が発生し、この磁場によって、ばらばらの方向を向いている π 中間子は前方を向くように曲げられるのである。このアル ミ管の形が楽器のホルンに似ていることから、電磁ホーンと呼ばれている。



図 A.1: 電磁ホーンの概念図。

図 A.2 に第1電磁ホーンのの断面概念図を示す。π中間子を収束させるのには 2Tの磁場が必要で、その磁場を発生させるためには 320 kA という大電流を流す必要がある。このような大電流を流し続けると巨大なジュール熱が発生しアルミニウムが融けてしまうため、陽子ビームのパルスに合わせて、100分の1秒程度の瞬間的なパルス電流を発生させる。その瞬間、発生した磁場と管を流れる電流が電磁相互作用(ローレンツ力)を起こして、20気圧の圧力が内管にかかることになる。このため、パルス電流を流すたびにローレンツ力によって弾かれた金属が、パッーンという大きな音と振動を発する。冷水ノズルが



図 A.2: 第1電磁ホーンの断面概念図。内管の中心に挿入されているのが、グラファイト標 的である。左側の赤い部分を通して電流が流される。外管にはジュール熱やビームによっ て発生する熱を水冷するためのノズルが付いている。

曲線を描いているのは、この振動を吸収するために設計されたものである。 図 A.3 に、電磁ホーンの写真を載せる。

付 録 A 電磁ホーン



図 A.3: 電磁ホーンの写真。(上)全体写真。 (下)外管および冷水ノズル。

謝辞

本研究にあたって、本研究室の奥沢 徹先生、清矢 良浩先生、山本 和弘先生、ならびに 京都大学大学院理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第二教室 高エネルギー物理学 研究室の松岡 広大氏、久保 一氏には多大なご迷惑をおかけしてしまいました。、お詫び申 し上げます。

先生方には、最後まで適切なご指導とお心遣いや励ましをいただき、心から感謝致しま す。また、T2K実験という大きな実験の一端に触れることでき嬉しく感じています。あり がとうございました。

また、現在 fermi 研究所に滞在中の脇坂 隆之氏、社会人になられた柳田 大樹氏には、生 活面でも色々お世話になりました。同研究室で同じ学年の濱口 敦成氏には、一緒に KEK のシフトに行ったりと、色々お世話になりました。同研究室の田代 一晃氏、篠原 奈生氏、 吉田 美奈氏は若いパワーで楽しく過ごさせてもらいました。重力波実験物理学研究室の徳 田 充氏、宇宙・素粒子実験物理学研究室の中川 真介氏、中山 雅央氏とはいつも一緒に話 をしたり食事をしたりとお世話になりました。影ながら支えていてくれた家族にも感謝し たいと思います。

皆様、本当にありがとうございました。これから、支えて下さった皆様のためにも、頑張っていきたいと思います。

関連図書

- [1] T2K 長基線ニュートリノ振動実験 ミューオンモニターの開発,
 京都大学大学院理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第二教室 高エネルギー物
 理学研究室 松岡広大, 修士論文,(2007)
- [2] Beam test(2007/6),
 ND280_kubo_0808.pdf, 京都大学大学院理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第
 二教室 高エネルギー物理学研究室 久保一,
- [3] Diamond detector,
 J.Conway et al., 'The Status of Diamond Detectors and a Proposal for R & D for CDF Beyond Run II', CDF/DOC/TRACKING/PUBLIC/4233, July 10, 1997
- [4] Diamond detector,
 The RD42 Collaboration, 'Review of the Development of Diamond Radiation Sensors', May 25, 1999
- [5] Diamond detector,Property of radiation detector using synthetic diamond, Tukasa ASO
- [6] Diamond detector, ダイヤモンド薄膜, 犬塚直夫・澤邊厚仁 著
- [7] Diamond detector,ダイヤモンド薄膜 -非平衡状態からの出発, 犬塚直夫 著
- [8] Neutrino oscillation,
 Donald H.Perkins, ' Introduction to High Energy Physics -4th edition-' GAM-BRIDGE
- [9] Neutrino oscillation,

Halzen, F., Martin, Alan D., 'Quarks and leptons : an introductory course in modern particle physics'

- [10] Neutrino oscillation, http://www.kek.jp/newskek/2005/julaug/k2k-5.html
- [11] Electromagnetic Horn, http://www.kek.jp/newskek/2006/julaug/T2Kmagnet2.html